

**关于锦州神工半导体股份有限公司
向特定对象发行股票申请文件的审核问
询函中有关财务会计问题的专项说明**

容诚专字[2026]110Z0393 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国·北京

目 录

1.关于本次募投项目及融资规模	2
2.关于业务与经营情况	34

**关于锦州神工半导体股份有限公司
向特定对象发行股票申请文件的审核问询函
中有关财务会计问题的专项说明**

容诚专字[2026]110Z0393 号

上海证券交易所：

贵所于 2026 年 8 月 11 日出具的《关于对锦州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2026〕169 号，以下简称“《问询函》”）已收悉。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“我们”或“申报会计师”）作为锦州神工半导体股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“神工股份”）向特定对象发行证券的申报会计师，对问询函涉及会计师的相关问题进行了逐项核查，现回复如下，请予以审核。

1. 关于本次募投项目及融资规模

根据申报材料：（1）本次向特定对象发行股票募集资金总额预计不超过 100,000.00 万元，拟投向硅零部件扩产项目、碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目和新建研发中心项目；（2）本次募投项目实施主体为公司神工股份及其控股子公司锦州精合、锦州精辰；（3）前次募投集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目于 2026 年 1 月终止；（4）硅零部件扩产项目的税后内部收益率为 24.34%，投资回收期（税后）为 5.75 年；碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目的税后内部收益率为 28.63%，投资回收期（税后）为 5.27 年。

请发行人说明：（1）公司前次募投项目终止原因、已投入资金效益实现情况，前次募投项目终止相关因素是否构成本次募投项目实施的重大障碍，并结合公司业务规划、行业发展趋势、前募终止原因及时点等情况，说明本次募投项目实施的必要性以及未将前次募集资金投入本次募投项目的合理性；（2）本次募投项目具体产品，是否涉及新产品，新产品与公司现有产品在原材料、技术、客户等方面是否具有相关性、协同性，结合本募产品当前研发环节、公司研发生产模式、技术及人员储备等，

说明相关产品技术、生产程序是否具有可行性，募集资金是否符合投向主业相关要求；

（3）结合新建研发中心项目的内部结构、功能规划及相关设施的具体用途情况，以及公司业务规划、现有研发人员数量、人均研发面积、同行业可比公司等情况，说明本次新建研发中心的必要性、合理性，募集资金是否符合投向科技创新领域要求；

（4）结合本次募投项目产品现有及规划产能、现有产能利用率及产销率、市场空间、公司竞争优势、客户储备、在手及意向订单等情况，说明本次募投项目产能规划的合理性及相关产能消化措施；（5）实施本募的控股子公司其他股东是否同比例增资或提供贷款，主要条款情况，是否存在损害上市公司利益的情形；（6）前次募投项目变更前后非资本性支出占比情况；（7）本次募投各项目的具体投资构成及相关测算依据的公允性，与公司同类项目及同行业可比公司项目是否存在重大差异；结合公司业务规模、资产负债结构、可自由支配资金持有及用途、报告期内开展投资活动具体情况、未来资金需求等，说明公司本次融资的必要性、融资规模的合理性；（8）公司硅零部件扩产、碳化硅陶瓷零部件研发及生产的具体产品类型及与报告期内公司产品的对应关系，并结合上述情况说明本次募投项目效益测算中单价、销量及毛利率等主要指标的测算依据，本次募投项目效益测算是否谨慎合理。

请保荐机构核查并发表明确核查意见，请发行人律师对问题（5）、申报会计师对问题（6）-（8）核查并发表明确意见。

回复：

发行人说明：

六、前次募投项目变更前后非资本性支出占比情况

公司前次募集资金投资项目（即“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”）存在变更事项。根据公司2026年1月23日第三届董事会第十一次会议、2026年2月10日2026年第一次临时股东会会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止，并将节余募集资金永久补充流动资金。

前次募投项目变更前后相关非资本性支出占比情况如下：

单位：万元

序号	承诺投资项目	承诺投入募集资金总额	其中：非资本性支出金额	承诺投入募集资金净额	变更前		变更后		
					实际投资金额	其中：非资本性支出金额	承诺投入募集资金金额	实际投资金额	其中：非资本性支出金额
1	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	21,000.00	-	20,905.66	8,257.64	-	8,257.64	8,257.64	-
2	补充流动资金项目	9,000.00	9,000.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	8,748.11	8,748.11
3	节余募集资金永久补充流动资金	-	-	-	-	-	13,223.57	13,223.57	13,223.57
合计		30,000.00	9,000.00	29,605.66	16,957.64	8,700.00	30,181.21	30,229.32	21,971.68

注：根据公司 2026 年 1 月 23 日第三届董事会第十一次会议、2026 年 2 月 10 日 2026 年第一次临时股东会会议，审议通过《关于终止部分募投项目并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将公司募投项目“集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目”予以终止，公司已于 2026 年 3 月将节余募集资金 13,223.57 万元（含募集资金利息收入及理财收益）补充到公司银行存款账户。相关募集资金专户均已于 2026 年 3 月 13 日完成注销，截至 2026 年 3 月 31 日，募投项目已终止且募集资金已使用完毕并销户。

公司前次募集资金总额为人民币 30,000.00 万元，扣除不含税的发行费用人民币 394.34 万元后，实际募集资金净额为人民币 29,605.66 万元。

前次募集资金投资项目变更前后非资本性支出占比情况如下：

单位：万元

序号	项目	金额
1	募集资金总额（A）	30,000.00
2	项目变更前非资本性投入总额（B）	9,000.00
3	项目变更后非资本性投入总额（C）	21,971.68
4	非资本性投入占比（项目变更前）（D=B/A）	30.00%
5	非资本性投入占比（项目变更后）（E=C/A）	73.24%
6	非资本性投入超支金额（项目变更后）（F=C-A*30%）	12,971.68

公司前次募集资金非资本性支出超过 30%部分，即 12,971.68 万元，已在本次拟募集资金总额中扣减。

七、本次募投各项目的具体投资构成及相关测算依据的公允性，与公司同类项目及同行业可比公司项目是否存在重大差异；结合公司业务规模、资产负债结构、可自由支配资金持有及用途、报告期内开展投资活动具体情况、未来资金需求等，说明公司本次融资的必要性、融资规模的合理性

（一）本次募投各项目的具体投资构成及相关测算依据的公允性，与公司同类项目及同行业可比公司项目是否存在重大差异

考虑公司前次募集资金非资本性支出存在超过 30%的情况及本次发行董事会决议日前六个月内存在少量财务性投资金额，调整后本次拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币 81,028.32 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

序号	项目名称	实施主体	总投资（万元）	拟使用募集资金（万元）
1	硅零部件扩产项目	锦州精合	57,747.25	41,369.28
2	碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目	锦州精辰	30,138.46	23,659.04
3	新建研发中心项目	神工股份	20,643.13	16,000.00
合计			108,528.84	81,028.32

注 1：上述项目总投资合计 108,528.84 万元，按调整后的计划，拟使用募集资金合计 81,028.32 万

元，差额部分由公司自有或自筹资金投入。

注 2：上表拟投入募集资金金额为扣除相关发行费用后的募集资金净额。

1、本次募投各项目的具体投资构成及相关测算依据的公允性

(1) 硅零部件扩产项目投资构成及相关测算依据的公允性

硅零部件扩产项目总投资 57,747.25 万元，其中建设投资 55,023.64 万元，占比 95.28%；铺底流动资金 2,723.61 万元，占比 4.72%。具体投资构成如下：

序号	项目	投资额（万元）	占总投资比例
1	建筑工程费	14,702.42	25.46%
2	设备及软件购置费	35,936.70	62.23%
3	工程建设其他费用	1,764.35	3.06%
4	预备费	2,620.17	4.54%
建设投资小计		55,023.64	95.28%
5	铺底流动资金	2,723.61	4.72%
合计		57,747.25	100.00%

①建筑工程费

本项目建筑工程费 14,702.42 万元，新建建筑面积 14,034.00 平方米。主体建筑主要包括厂房及预留车间；其他工程主要为生产辅助设施，涵盖净化空调、舒适性空调、纯水、废水、气体、配电室变压器、二次配及附属设施等配套系统工程。建设价格参照公司历史经验以及市场价格确定。本项目单位造价建筑工程费估算详见下表：

序号	名称	工程量（平方米）	单位造价（万元/平方米）	投资额（万元）
一	主体建筑	14,034.00	0.44	6,122.42
1	厂房 4	2,838.00	0.54	1,522.74
2	厂房 5	3,630.00	0.47	1,704.90
3	厂房 6	1,980.00	0.81	1,610.00
4	预留车间	5,586.00	0.23	1,284.78
二	其他工程	-	-	8,580.00
合计		14,034.00	1.05	14,702.42

公司同类项目及同行业可比上市公司项目对比如下：

公司名称	项目	建筑工程费（万元）	建筑面积（平方米）	单位造价（万元/平方米）
本次募投项目				

公司名称	项目	建筑工程费 (万元)	建筑面积 (平方米)	单位造价 (万元/平方米)
发行人	硅零部件扩产项目	6,122.42	14,034.00	0.44
	碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目	2,478.93	11,007.00	0.23
	新建研发中心项目	2,717.50	4,590.00	0.59
	合计	11,318.85	29,631.00	0.38
前次募投项目				
发行人	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	15,658.32	30,886.00	0.51
	8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目	10,432.41	40,670.50	0.26
	研发中心建设项目	2,979.87	5,351.40	0.56
	合计	29,070.60	76,907.90	0.38
臻宝科技	半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	19,606.14	65,353.80	0.30
	臻宝科技研发中心项目	4,329.00	10,600.00	0.41
先锋精科	半导体先进制程金属器件扩建项目	16,509.80	43,800.00	0.38
	半导体先进制程非金属材料及器件研发、生产新建项目	10,637.30	27,650.00	0.38
	半导体设备用陶瓷静电吸盘研发项目	570.00	1,500.00	0.38
珂玛科技	结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目	20,176.00	未披露	-
	半导体设备用碳化硅材料及部件项目	420.00	5,135.39	0.08

注 1：发行人募投项目中存在其他工程，建设内容较为多元，且无法核算面积，为便于数据可比，单位造价系按照主体建筑面积及对应建筑工程费计算。

注 2：厂房 6 因功能及配套建设需要做防腐处理，故平均造价高于厂房 4、厂房 5。

本次募投项目的建筑单价与发行人前次募投项目相近，公司在审慎控制厂房建设和装修造价，本次测算符合公司建设与装修成本的一贯性。

发行人本次募投项目中新建研发中心项目单位建造成本较高，主要系该项目对厂房的洁净度、装修要求较高。建筑单价位于可比项目区间内，与可比项目不存在重大差异。

综上，本次募投项目根据历史建设经验并参考市场价格匹配生产及研发工艺标准进行高标准厂房建设，确保募投项目能够切实满足募投项目生产及研发条件，建筑及装修单价测算审慎，具有合理性。

②设备及软件购置费

公司购置的设备及软件主要是用于仓房生产管理、质量检测、日常办公。设备的数量基于该项目预计需求而确定；单价主要参照相同或类似规格/型号设备历史采购价格和市场报价、询价价格，总计 405 台/套，总价 34,460.70 万元。设备构成情况如下：

序号	设备名称	数量（台/套）	总价（万元）
1	生产设备	330	33,129.30
2	检测设备	25	1,291.40
3	办公设备	50	40.00
合计		405	34,460.70

其中公司采购生产设备数量较多、总价较高。生产设备采购明细如下：

序号	设备名称	数量（台/套）	单价（万元）	总价（万元）
1	数控切削加工设备	279	95.42	26,623.10
2	激光特种加工设备	8	230.93	1,847.40
3	抛光及表面后处理设备	10	87.92	879.20
4	刻蚀清洗工艺设备	27	118.35	3,195.50
5	辅助配套及包装类设备	6	97.35	584.10
合计		330	100.39	33,129.30

本项目软件购置分为生产用软件、仓储物流软件、办公软件三大类；数量基于该项目预计需求而确定；单价主要参照相同或类似规格/型号设备历史采购价格和市场报价、询价价格，总计 195 套，总投资 1,476.00 万元。具体如下：

序号	设备名称	数量（套）	总价（万元）
1	生产用软件	3	470.00
2	仓储物流软件	1	120.00
3	办公软件	191	886.00
合计		195	1,476.00

③工程建设其他费用

工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费等，合计为 1,764.35 万元，测算依据如下：

序号	费用名称	总价（万元）	计价依据
1	建设单位管理费	253.20	根据《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）取值，取建筑工程费、设备购置费的 0.50%

序号	费用名称	总价（万元）	计价依据
2	前期工作费	50.00	结合市场价格和历史经验确定
3	勘察设计费	506.39	根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号），取建筑工程费、设备购置费的 1.00%
4	临时设施费	73.51	根据《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号），临时设施费按建筑工程费的 0.50%估算
5	工程监理费	405.11	根据《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号），工程监理费取建筑工程费、设备购置费的 0.80%
6	工程保险费	303.83	根据《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号），工程保险费取建筑工程费、设备购置费的 0.60%
7	联合试运转费	172.30	根据《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号），联合试运转费按照设备购置费的 0.50%估算
合计		1,764.35	-

④预备费

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费。

根据《市政工程设计概算编制办法》，基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备购置费和工程建设其他费用之和的 5.00%，基本预备费计 2,620.17 万元。

涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340号）精神，投资价格指数按零计算。

⑤铺底流动资金

铺底流动资金是指项目建设后期至项目运营初期，涉及到试运行、小批量生产阶段，尚未形成稳定收入及现金流入，为解决短期现金流缺口投入的流动资金。根据建设单位最近两年公司各项主要流动资产、流动负债的周转情况，测算本项目所需流动资金。本项目正常年流动资金需用额为 13,618.03 万元，其中铺底流动资金 2,723.61 万元，占正常年流动资金需用额的 20%。

（2）碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目投资构成及相关测算依据的公允性

碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目总投资 30,138.46 万元，其中建设投资 29,067.37 万元，占比 96.45%；铺底流动资金 1,071.09 万元，占比 3.55%。具体投资构成如下：

序号	项目	投资额（万元）	占总投资比例
1	建筑工程费	7,808.93	25.91%
2	设备及软件购置费	18,923.15	62.79%
3	工程建设其他费用	951.13	3.16%
4	预备费	1,384.16	4.59%
小计		29,067.37	96.45%
5	铺底流动资金	1,071.09	3.55%
合计		30,138.46	100.00%

①建筑工程费

本项目建筑工程费 7,808.93 万元，总建筑面积 11,007.00 平方米（其中利用现有厂房 6,378.00 平方米，新建 4,629.00 平方米）。主体建筑主要为厂房；其他工程主要包括工艺冷却水、超纯水、废气、污水、空压机、特种气体集中供应、洁净干燥空气、MTS 集中供应、舒适性空调、配电室变压器电缆、二次配及附属设施、绿化、外网道路围墙大门等公用配套及基础设施工程。建设价格参照公司历史经验以及市场价格确定。建筑工程费估算详见下表：

序号	名称	工程量 (平方米)	单位造价 (万元/平方米)	投资额 (万元)
一	主体建筑	11,007.00	0.23	2,478.93
1	厂房 1（仅装修）	6,378.00	0.03	191.34
2	厂房 2	1,650.00	0.59	981.00
3	厂房 3	2,838.00	0.44	1,254.24
4	仓库	105.00	0.46	45.15
5	门卫房	36.00	0.20	7.20
二	其他工程	-	-	5,330.00
合计		11,007.00	0.71	7,808.93

本募投项目与公司历史项目及同行业可比项目具有可比性，详见本问询回复问题一之“（一）本次募投各项目的具体投资构成及相关测算依据的公允性，与公司同类项目及同行业可比公司项目是否存在重大差异”之“1、本次募投各项目的具体投资构成及相关测算依据的公允性”内容。

②设备及软件购置费

公司购置的设备及软件主要是用于仓房生产管理、质量检测、日常办公。设备的

数量基于该项目预计需求而确定；单价主要参照相同或类似规格/型号设备历史采购价格和市场报价、询价价格，总计 116 台/套，总价 17,370.40 万元。设备构成情况如下：

序号	设备名称	数量（台/套）	总价（万元）
1	生产设备	73	14,415.00
2	检测设备	21	2,934.00
3	办公设备	22	21.40
合计		116	17,370.40

公司采购生产设备数量较多、总价较高。生产设备采购明细如下：

序号	设备名称	数量（台）	单价（万元）	总价（万元）
1	开料切割分切设备	23	32.17	740.00
2	数控机械加工设备	26	141.35	3,675.00
3	热工与合成制备设备	12	766.67	9,200.00
4	化学清洗处理设备	8	100.00	800.00
合计		69	208.91	14,415.00

项目软件购置分为生产用软件、仓储物流软件、办公软件三大类；主要参照相同或类似规格/型号设备历史采购价格和市场报价、询价价格等因素确定采购单价，总计 163 套，总投资 1,552.75 万元。具体如下：

序号	软件名称	数量（套）	总价（万元）
1	生产用软件	34	1,160.00
2	仓储物流软件	3	310.00
3	办公软件	126	82.75
总计		163	1,552.75

③工程建设其他费用

工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费等，合计为 951.13 万元，测算依据如下：

序号	费用名称	总价（万元）	计价依据
1	建设单位管理费	133.66	根据《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504号）取值，取建筑工程费、设备购置费的 0.50%
2	前期工作费	50.00	结合市场价格和历史经验确定
3	勘察设计费	267.32	根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号），取建筑工程费、设备购置费的 1.00%
4	临时设施费	39.04	根据《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号），

序号	费用名称	总价（万元）	计价依据
			临时设施费按建筑工程费的 0.50%估算
5	工程监理费	213.86	根据《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号），工程监理费取建筑工程费、设备购置费的 0.80%
6	工程保险费	160.39	根据《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号），工程保险费取建筑工程费、设备购置费的 0.60%
7	联合试运转费	86.85	根据《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164号），联合试运转费按照设备购置费的 0.50%估算
合计		951.13	-

④预备费

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费。

根据《市政工程设计概算编制办法》，基本预备费取建筑工程费、设备购置费和工程建设其他费用之和的 5.00%，基本预备费计 1,384.16 万元。

涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340号）精神，投资价格指数按零计算。

⑤铺底流动资金

铺底流动资金是指项目建设后期至项目运营初期，涉及到试运行、小批量生产阶段，尚未形成稳定收入及现金流入，为解决短期现金流缺口投入的流动资金。根据公司最近两年各项主要流动资产、流动负债的周转情况，测算本项目所需流动资金。本项目流动资金估算按照分项详细估算法进行估算。本项目正常年流动资金需用额为 5,355.47 万元，其中铺底流动资金 1,071.09 万元，占正常年流动资金需用额的 20%。

（3）新建研发中心项目投资构成及相关测算依据的公允性

新建研发中心项目总投资 20,643.13 万元，无铺底流动资金。具体投资构成如下：

序号	项目	投资额（万元）	占总投资比例
1	建筑工程费	3,287.50	15.93%
2	设备及软件购置费	14,297.00	69.26%
3	工程建设其他费用	2,151.59	10.42%
3.1	其中：研发费用	1,595.20	7.73%
4	预备费	907.04	4.39%
合计		20,643.13	100.00%

①建筑工程费

本项目建筑工程费 3,287.50 万元，建筑面积 4,590.00 平方米。研发大类主要包括实验室及办公区，其他工程包含纯水、废水、气体集中供应、二次配及附属设施等公用基础设施工程。建设价格参照公司历史经验以及市场价格确定。建筑工程费详见下表：

序号	名称	工程量 (平方米)	单位造价 (万元/平方米)	投资额 (万元)
一	研发大楼	4,590.00	0.59	2,717.50
1	办公区	760.00	0.25	190.00
2	实验室	3,830.00	0.66	2,527.50
二	其他工程	-	-	570.00
合计		4,590.00	0.72	3,287.50

本募投项目与公司历史项目及同行业可比项目具有可比性，详见本问询回复问题一之“（一）本次募投各项目的具体投资构成及相关测算依据的公允性，与公司同类项目及同行业可比公司项目是否存在重大差异”之“1、本次募投各项目的具体投资构成及相关测算依据的公允性”内容。

②设备及软件购置费

本项目设备及软件购置费 14,297.00 万元，其中设备购置费 13,938.00 万元，软件购置费 359.00 万元。本项目设备购置合计 13,938.00 万元，共计 94 台/套，涵盖烧结碳化硅设备、高纯碳化硅粉末设备、通用精密检测设备、专用精密检测设备及办公设备。

硬件设备选型遵循技术先进、性能可靠、经济适用的原则，单价参考市场价格以及历史采购价格确定。设备情况见下表：

序号	设备名称	数量（台/套）	总价（万元）
1	烧结碳化硅设备	16	3,640.00
2	高纯碳化硅粉末设备	25	3,270.00
3	通用精密检测设备	23	2,753.00
4	专用精密检测设备	5	4,250.00
5	办公设备	25	25.00
合计		94	13,938.00

项目软件购置分为研发用软件、办公软件两大类；数量基于该项目预计需求而确定；单价主要参照相同或类似规格/型号设备历史采购价格和市场报价、询价价格，总

计 31 套，项目新增软件详见下表：

序号	设备名称	数量（套）	总价（万元）
1	研发软件	6	350.00
2	办公软件	25	9.00
合计		31	359.00

③工程建设其他费用

工程建设其他费用主要包括建设单位管理费、勘察设计费、工程监理费等，合计为 2,151.59 万元，测算依据如下：

序号	费用名称	总价（万元）	计价依据
1	建设单位管理费	87.92	根据《基本建设项目建设成本管理规定》（财建[2016]504 号）取值，取建筑工程费、设备购置费的 0.50%
2	前期工作费	30.00	结合市场价格和历史经验确定
3	勘察设计费	175.85	根据《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号），取建筑工程费、设备购置费的 1.00%
4	临时设施费	16.44	根据《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164 号），临时设施费按建筑工程费的 0.50%估算
5	工程监理费	140.68	根据《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164 号），工程监理费取建筑工程费、设备购置费的 0.80%
6	工程保险费	105.51	根据《市政工程投资估算编制办法》（建标[2007]164 号），工程保险费取建筑工程费、设备购置费的 0.60%
7	研发费用	1,595.20	公司测算
合计		2,151.59	-

公司研发费用 1,595.20 万元，其中人员工资 835.20 万元，其他研发费用 760.00 万元。公司项目人员工资参考公司研发人员薪酬，并按照 1.2 万元/月/人测算，T+1 年至 T+3 年，公司本项目研发人员数量分别为 21 人、21 人、16 人。具体详见下表：

序号	名称	T+1 （万元）	T+2 （万元）	T+3 （万元）	合计 （万元）
一	研发人员费用				
1	碳化硅烧结体研发项目	115.20	115.20	86.40	316.80
2	通用精密检测项目	43.20	43.20	43.20	129.60
3	专用精密检测项目	57.60	57.60	43.20	158.40
4	高纯碳化硅粉末研发项目	86.40	86.40	57.60	230.40
小计		302.40	302.40	230.40	835.20
二	其他研发费用				

序号	名称	T+1 (万元)	T+2 (万元)	T+3 (万元)	合计 (万元)
1	研发耗材	200.00	200.00	200.00	600.00
2	试制加工费	12.00	22.00	28.00	62.00
3	第三方检测费	8.00	12.00	15.00	35.00
4	委外研发费	20.00	15.00	10.00	45.00
5	其他费用	5.00	6.00	7.00	18.00
小计		245.00	255.00	260.00	760.00
合计		547.40	557.40	490.40	1,595.20

④预备费

项目预备费包括基本预备费和涨价预备费。

根据《市政工程设计概算编制办法》，基本预备费取建设投资中建筑工程费、设备及软件购置费和工程建设其他费用（不含研发费用）之和的 5.0%，基本预备费计 907.04 万元。

涨价预备费参照国家计委《关于加强对基本建设大中型项目概算中“价差预备费”管理有关问题的通知》（计投资[1999]1340 号）精神，投资价格指数按零计算。

2、与公司同类项目及同行业可比公司项目的对比分析

（1）与公司同类项目的对比

①工程费用投资

公司历次募投项目均遵循半导体精密零部件“重设备、重厂房固定资产投入”的核心投资逻辑，本次三个项目工程投资占比落在历史项目区间内，资金主要投向生产及研发硬件资产购置，投资重心未发生明显变化，延续公司募投项目一贯投资特征。

项目批次	项目名称	工程费用（万元）	工程费用占总投资比例
2020 年 IPO	8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目	82,099.48	94.45%
2020 年 IPO	研发中心建设项目	22,932.82	98.52%
2023 年小额快速	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	26,043.19	84.33%
本次募投	硅零部件扩产项目	52,403.47	90.75%
本次募投	碳化硅陶瓷零部件研发及产业化项目	27,683.21	91.85%

本次募投	新建研发中心项目	18,140.89	87.88%
------	----------	-----------	--------

②预备费

本次募投项目预备费按照《市政工程设计概算编制办法》区间计取，计提标准合理，本次募投项目预备费计提比例区间为 4.39%-4.59%，与 2023 年小额快速再融资募投项目处于同一可比区间。

本次募投项目中碳化硅陶瓷零部件研发及产业化项目预备费金额占比略高于其他募投项目，主要系碳化硅陶瓷零部件属于全新工艺产线，设备定制、工艺调试及建设期不确定因素多于成熟硅材料扩产项目，足额计提预备费用于覆盖物价波动、工程微调、设备交付变更等潜在支出，测算具备审慎性。

项目批次	项目名称	预备费（万元）	预备费占总投资比例
2020 年 IPO	8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目	1,283.00	1.42%
2020 年 IPO	研发中心建设项目	343.99	1.48%
2023 年小额快速	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	1,283.00	4.15%
本次募投	硅零部件扩产项目	2,620.17	4.54%
本次募投	碳化硅陶瓷零部件研发及产业化项目	1,384.16	4.59%
本次募投	新建研发中心项目	907.04	4.39%

③铺底流动资金

本次募投项目公司铺底流动资金采用分项详细估算法测算，存货、应收及应付账款周转天数基于自身历史经营数据取值，铺底流动资金占比差异由业务协同效应、产品品类属性差异形成。

本次项目铺底流动资金占比与 2020 年 IPO 募投项目较为可比。但较 2023 年小额快速再融资募投项目有所下降，主要原因包括：一是硅零部件、碳化硅业务可共享公司现有硅材料原材料采购、仓储及客户回款渠道，资产周转效率更高，营运资金需求更低；二是碳化硅陶瓷属于新品，产能分年度逐步爬坡，流动资金随产能渐进投放，无需一次性大额垫资；三是 2023 年项目产品为刻蚀设备用硅材料，原材料单价较高，备货资金占用规模更大。

项目批次	项目名称	铺底流动资金（万元）	铺底流动资金占总投资比例
2020 年 IPO	8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目	3,592.44	4.13%
2023 年小额快速	集成电路刻蚀设备用硅材料扩产项目	3,553.00	11.53%
本次募投	硅零部件扩产项目	2,723.61	4.72%
本次募投	碳化硅陶瓷零部件研发及产业化项目	1,071.09	3.55%

（2）与同行业可比公司募投项目的对比

①硅零部件扩产项目、碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目与同行业公司的对比分析

硅零部件扩产项目、碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目与同行业公司的对比分析情况如下：

可比公司	项目名称	总投资（万元）	工程建设费用（万元）	工程建设费用占总投资比例	预备费	预备费占总投资比例	铺底流动资金	铺底流动资金占总投资比例
臻宝科技	半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目	81,061.3 ₂	75,834.53	93.55%	1,516.69	1.87%	3,710.1 ₀	4.58%
先锋精科	半导体先进制程金属器件扩建项目	30,401.5 ₅	27,509.08	90.49%	550.18	1.81%	2,342.2 ₉	7.70%
	半导体先进制程非金属材料及器件研发、生产新建项目	26,470.5 ₇	23,701.03	89.54%	493.13	1.86%	2,276.4 ₁	8.60%
珂玛科技	结构功能模块化陶瓷部件产品扩建项目	60,273.0 ₀	49,990.00	82.79%	982.00	1.63%	9,391.0 ₀	15.58%
	半导体设备用碳化硅材料及部件项	6,542.42	5,420.42	82.85%	106.00	1.62%	1,016.0 ₀	15.53%

可比公司	项目名称	总投资 (万元)	工程建设 费用(万元)	工程建 设费用 占总投资 比例	预备费	预备 费占 总投资 比例	铺底流 动资金	铺底流 动资金 占总投资 比例
	目							
发 行 人	硅零部件扩 产项目	57,747.2 5	52,403.47	90.75%	2,620.17	4.54%	2,723.6 1	4.72%
	碳化硅陶瓷 零部件研发 及产业化建 设项目	30,138.4 6	27,683.21	91.85%	1,384.16	4.59%	1,071.0 9	3.55%

A、工程建设费用

硅零部件扩产项目、碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目工程建设费用分别为 90.75%、91.85%，可比公司投资项目工程建设费用占比区间为 82.79%-93.55%，处于同一可比区间，与臻宝科技半导体及泛半导体精密零部件及材料生产基地项目、先锋精科可比项目的工程建设费用投入占比较为接近。

硅零部件扩产项目、碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目与臻宝科技、先锋精科项目均以产能建设为核心导向，资金重点投向生产场地建设与核心设备购置，符合半导体精密零部件扩产项目“重资产、重产能落地”的普遍特征，投入结构与项目定位匹配。

珂玛科技项目占比偏低，主要系所投资项目铺底流动资金占比超过 15%，压缩了工程建设费用投入比例。

B、预备费

硅零部件扩产项目、碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目预备费占比分别为 4.54%、4.59%，高于可比公司 1.63%-1.87%的水平。发行人足额计提预备费用于覆盖物价波动、工程微调、设备交付变更等潜在支出，测算具备审慎性。

根据《市政工程设计概算编制办法》，基本预备费常规计取区间为 5%-8%，本项目根据建设需求，基本预备费按工程费用与工程建设其他费用之和的 5%计提，处于行业规范区间下限，计提标准合规。

C、铺底流动资金

硅零部件扩产项目、碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目铺底流动资金占比分别为 4.72%、3.55%，与臻宝科技同类项目处于可比范围，低于珂玛科技、先锋精科同类项目。

铺底流动资金所需投入系发行人根据建设单位最近两年公司各项主要流动资产、流动负债的周转情况，测算项目所需流动资金。珂玛科技、先锋精科项目流动资金占比较高，与其自身采购结算模式、营运特点相关。

②新建研发中心建设项目与同行业的对比分析

新建研发中心建设项目与同行业的对比分析情况如下：

可比公司	项目名称	总投资（万元）	工程建设费用（万元）	工程建设费用占总投资比例	预备费（万元）	预备费占总投资比例	研发费用（万元）	研发费用占总投资比例
珂玛科技	研发中心建设项目	34,711.22	29,074.63	83.76%	680.61	1.96%	4,955.99	14.28%
臻宝科技	臻宝科技研发中心建设项目	30,274.42	18,508.50	61.14%	593.61	1.96%	11,172.31	36.90%
	上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目	17,000.68	9,143.66	53.78%	333.34	1.96%	7,523.68	44.26%
发行人	新建研发中心项目	20,643.13	18,140.89	87.88%	907.04	4.39%	1,595.20	7.73%

A、工程建设费用

公司新建研发中心项目工程建设费用占比 87.88%，与珂玛科技同类项目较为可比，但远高于臻宝科技同类项目工程建设费用占比区间，核心差异为项目投入重点与研发模式不同。臻宝科技研发项目中研发费用投入占比较高，特别是上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目系租赁厂房模式，工程建设费用占比进一步降低。

臻宝科技研发中心建设项目、上海臻宝半导体装备零部件研发中心项目研发费用

占比分别为 36.90%、44.26%，主要以人员薪酬、委外研发、课题试制等费用化投入为主，硬件资产投入占比较低；珂玛科技研发中心偏软硬件结合，工程建设占比居中。公司新建研发中心项目核心定位为搭建碳化硅研发与检测硬件平台，资金重点投向高端试验设备、精密检测仪器及研发场地装修，以资本性支出为主，因此工程建设投入占比更高，投入结构与项目定位高度契合，具备合理性。

B、预备费

本项目预备费占比 4.39%，按建筑工程费、设备及软件购置费、工程建设其他费用（不含研发费用）之和的 5%计提，研发费用不计入预备费计算基数。

C、研发费用

本项目研发费用占比 7.73%，低于可比公司 14.28%-44.26%的区间，主要系本项目核心定位为搭建碳化硅研发与检测硬件平台，资金重点投向高端试验设备、精密检测仪器及研发场地装修，以资本性支出为主，因此工程建设投入占比更高，投入结构与项目定位高度契合，具备合理性。

综上所述，本次募投各项目的投资构成合理，各项费用的测算依据充分、标准统一。建筑工程费参照历史以及行业工程造价水平确定，设备及软件购置费通过市场询价或参考既有采购价格确定，工程建设其他费用按行业惯例和规范费率计提，预备费率和铺底流动资金比例符合相关规定。三个募投项目之间在计价标准和费率上保持一致，与公司同类项目不存在重大差异，与同行业可比公司募投项目的投资构成结构和单价水平基本一致，不存在重大差异。本次募投项目投资构成及相关测算依据具有公允性。

（二）结合公司业务规模、资产负债结构、可自由支配资金持有及用途、报告期内开展投资活动具体情况、未来资金需求等，说明公司本次融资的必要性、融资规模的合理性

1、公司业务规模情况

报告期内，公司营业收入总体构成情况如下表所示：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	21,523.12	99.46%	43,565.48	99.46%	29,955.94	98.95%	12,944.38	95.86%
其他业务收入	117.44	0.54%	234.41	0.54%	317.01	1.05%	558.93	4.14%
合计	21,640.56	100.00%	43,799.89	100.00%	30,272.95	100.00%	13,503.32	100.00%

注：2026 年 1-6 月财务数据未经审计，下同。

公司主营业务收入主要来源于大直径硅材料、硅零部件的销售，其他业务收入主要为材料销售、加工费等零星收入，占比较低。报告期内，公司营业收入整体保持稳定增长态势。

2、资产负债结构情况

报告期各期末，公司资产负债率分别为 6.28%、7.21%、5.71%、5.76%，资产负债率水平较低。公司与同行业可比公司资产负债率具体对比情况如下：

公司简称	2026 年 6 月末	2025 年末	2024 年末	2023 年末
先锋精科	31.48%	24.57%	25.04%	30.54%
珂玛科技	46.61%	31.75%	22.77%	45.44%
有研硅	10.48%	8.87%	10.63%	11.37%
臻宝科技	12.49%	25.23%	23.67%	20.77%
平均值	25.27%	22.61%	20.53%	27.03%
发行人	5.76%	5.71%	7.21%	6.28%

注：数据来源于同行业可比公司已公开披露的定期报告。

报告期内，公司总体资产负债率低于同行业可比公司平均水平，主要系公司自 2016 年财务信息披露以来至报告期前的 2022 年度，销售净利率、经营性净现金流保持良好水平，且公司一直执行较为稳健的财务政策，保持较为安全的财务结构，将有息负债、应付款项等维持在较低水平，保持公司的稳健经营。

公司保持较低的资产负债率，预留较为充裕的流动性，能够为公司未来发展保留足够的财务灵活性，也为公司后续把握半导体产业扩张机遇、加快推进本次募投项目及其他公司自有资金投资项目实施奠定了良好的财务基础。

公司资产负债率维持较低水平情形下实施本次融资，系综合考虑公司未来资金需求所作出的战略发展规划，能够提高公司的抗风险能力，使公司资产负债结构始终处

于较为稳健、合理的水平。

3、可自由支配资金持有及用途

截至 2026 年 6 月 30 日，公司可自由支配资金为 94,287.81 万元，详情如下：

项目	计算公式	金额（万元）
报告期末货币资金余额	1	30,394.18
报告期末受限的货币资金	2	560.07
报告期末易变现的各类金融资产余额	3	63,441.26
其他流动资产	4	1,012.43
可自由支配资金	5=1-2+3+4	94,287.81

公司自由支配资金主要由货币资金、现金管理产品构成。自由支配资金未来主要用途为营运资金支出、自有资金项目投资及募投项目中总投资额超过募集资金差额部分投入等。

4、报告期内开展投资活动具体情况

报告期内，公司投资支出活动主要有两类：一是围绕满足持续增长的下游客户需求，巩固行业竞争地位，持续增加固定资产等资本性投入；二是基于公司审慎经营等原因积累的流动资金实施现金管理。

报告期内，公司投资活动现金流量情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
收回投资收到的现金	73,187.10	191,816.92	61,800.19	23,084.09
取得投资收益收到的现金	237.53	345.12	125.11	91.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.26	7.04	270.03	0.82
投资活动现金流入小计	73,424.89	192,169.08	62,195.32	23,176.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,148.88	17,406.56	12,393.11	15,489.36
投资支付的现金	87,196.10	182,879.34	95,329.50	40,701.72
投资活动现金流出小计	88,344.98	200,285.90	107,722.61	56,191.09
投资活动产生的现金流量净额	-14,920.09	-8,116.82	-45,527.28	-33,014.72

报告期内，公司主要投资项目包括固定资产投建及实施现金管理。其中，公司现金管理主要为购买流动性好、安全性高的银行及券商理财等现金管理产品，截至 2026

年 6 月 30 日，公司交易性金融资产金额为 63,441.26 万元。报告期内公司构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金主要系厂房及设备投资等。

5、未来资金需求

截至 2026 年 6 月 30 日，公司可自由支配资金余额为 94,287.81 万元。公司未来期间经营活动现金流净额合计 68,356.27 万元，预计未来期间资金需求合计金额为 271,481.34 万元。经测算公司未来资金缺口为 108,837.26 万元，公司本次募集资金金额不超过 81,028.32 万元，未超过公司资金需求。具体分析如下：

（1）经营规模及变动趋势分析

2023 年度，半导体行业的周期性波动导致半导体行业整体需求下降，下游客户仍以消化库存为主。全球经济增长受到持续高利率、地缘政治冲突的不利影响，全球经济大环境叠加半导体市场供求关系周期性变化，以及一些国家推出的半导体产业投资补贴政策和技术出口管制政策对供应链的扰动仍在持续，市场环境仍趋复杂。半导体行业整体上仍处于调整期，叠加全球通胀和地缘政治冲突等因素，2023 年全球市场表现乏力。基于上述背景，受终端需求减少的影响，公司 2023 年度经营规模较过往年度大幅下滑，营业收入为 2018 年以来最低水平。为充分考虑上述周期性因素，公司选取 2021 年至 2026 年上半年区间做变动趋势分析。

2021 年至 2026 年上半年，公司营业收入分别为 50,355.18 万元、53,923.65 万元、13,503.32 万元、30,272.95 万元、43,799.89 万元、21,640.56 万元。2026 年上半年营业收入同比增长率为 3.78%，假定 2026 年较 2025 年营业收入增长率按此增长率计算，2026 年经测算年化营业收入为 45,454.60 万元。据此，2021 年至 2026 年营业收入复合年均增长率为-2.03%。

发行人 2021 年至 2026 年上半年营业收入复合增长率为负，主要原因系全球半导体市场周期性波动影响所致。2021 年半导体行业市场情况良好，公司营业收入规模较高，故营业收入基数较高，2023 年受行业因素及公司产品及市场结构因素影响，公司营业收入触及周期底部，2024 年以来，受半导体市场逐步复苏回暖，公司经营状况持续改善，2026 年上半年营业收入已达到 2021 年同期经营水平。

（2）现金流状况

①过往经营活动产生的现金流净额占营业收入的比例

2021年至2026年上半年，公司经营活动现金流量净额平均值占营业收入平均值比重41.30%，假设2027年至2029年经营活动现金流量净额占营业收入比重为41.30%。

单位：万元

项目	2026年1-6月	2025年	2024年	2023年	2022年	2021年	均值
经营活动产生的现金流净额	13,412.41	17,326.20	17,292.98	8,220.95	13,014.65	18,912.53	14,696.62
营业收入	21,640.56	43,799.89	30,272.95	13,503.32	53,923.65	50,355.18	35,582.59
经营活动现金流净额/营业收入	61.98%	39.56%	57.12%	60.88%	24.14%	37.56%	41.30%

②未来期间预测的营业收入

近几年来，全球半导体设备行业在AI算力需求爆发、先进制程扩产及供应链自主可控驱动下高速增长。根据SEMI统计，2024年全球半导体设备销售额达1,171亿美元，同比增长10%，2025年全球半导体设备销售额达1,330亿美元，同比增长13.7%，其中作为全球最大的半导体市场，中国大陆半导体设备销售额增速远高于全球市场。SEMI同时预测，2027年全球设备规模将达1,560亿美元。根据世界半导体贸易统计协会（WSTS）2026年8月发布的数据，2026年全球半导体市场规模同比增长108%，达到16,550亿美元的历史新高，其中逻辑芯片市场增长28%，存储芯片市场增长36%。

公司大直径硅材料主要面向日本、韩国的知名硅零部件厂商，后者的产品销售给国际知名刻蚀机设备厂商，并最终销售给三星电子、SK海力士、英特尔、台积电等集成电路厂商，市场受海外市场景气度提升带动，营业收入保持较高增速。根据QY Research及弗若斯特沙利文的数据测算，2024年中国半导体设备硅零部件市场规模达到50亿元，2025年市场规模约为58亿元，考虑到未来全球存储芯片产能将进一步向中国大陆市场转移，对半导体设备硅零部件的需求将较大幅度提升，预计2030年中国半导体设备硅零部件市场规模将达到125亿元，2025-2030年年均复合增长率约为16.60%，公司预测未来硅零部件业务具有较高发展潜力。

2021年至2026年，公司所处半导体行业经历周期底部到逐步行业复苏的阶段。按照2026年经测算年化营业收入计算，初步测算2021年至2026年营业收入复合年均增长率为-2.03%。基于半导体市场下游趋势判断未来市场增量趋势整体向好，管理层预测2027年-2029年营业收入增长率为10%。

③未来期间经营活动现金流净额合计

未来三年，公司经营活动现金流净额具体测算如下：

单位：万元

项目	2027 年	2028 年	2029 年
营业收入	50,000.06	55,000.06	60,500.07
经营活动现金流量净额/营业收入	41.30%	41.30%	41.30%
经营活动现金流量净额	20,651.44	22,716.59	24,988.25
合计	68,356.27		

注：该数据仅为测算总体资金缺口所用，不代表公司对未来年度经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测，下同。

(3) 未来业务发展规划及利用资金需求

①最低现金保有量需求

最低现金保有量是公司维持其日常营运所需要的最低资金水平，根据最低现金保有量=年付现成本总额÷货币资金周转次数计算。货币资金周转次数主要受现金周转期影响，现金周转期系从对外采购承担付款义务，到收回因销售商品或提供劳务而产生应收款项的周期，因此现金周转期主要受到存货周转期、应收款项周转期及应付款项周转期的影响。

根据公司最近一个完整会计年度 2025 年度财务数据测算，公司在现行运营规模下日常经营需要保有的最低货币资金为 10,354.68 万元，具体测算过程如下：

单位：万元

项目	计算公式	计算结果
最低现金保有量	(1) = (2) / (3)	10,354.68
2025 年付现成本总额	(2) = (4) + (5) - (6)	20,763.09
2025 年营业成本	(4)	24,199.19
2025 年期间费用总额	(5)	6,284.62
2025 年非付现成本总额	(6)	9,720.73
货币资金周转次数（现金周转率）（次）	(3) = 360 / (7)	2.01
现金周转期（天）	(7) = (8) + (9) - (10)	179.53
存货周转期（天）	(8)	146.94
经营性应收项目周转期（天）	(9)	119.75
经营性应付项目周转期（天）	(10)	87.16

注 1：期间费用包括管理费用、销售费用、研发费用以及财务费用；

注 2：非付现成本总额包括当期固定资产折旧、使用权资产摊销、无形资产摊销以及长期待摊费用摊销等；

注 3：存货周转期=360/存货周转率；

注 4：经营性应收项目周转期=360×（平均应收账款账面余额+平均应收票据账面余额+平均应收款项融资账面余额+平均预付款项账面余额）/营业收入；

注 5：经营性应付项目周转期=360×（平均应付账款账面余额+平均应付票据账面余额+平均合同负债账面余额）/营业成本。

②未来期间新增最低现金保有量计算

最低现金保有量需求与公司经营规模相关，测算假设最低现金保有量的增速与目前公司报告期末最低现金保有量需求为基于 2025 年财务数据测算得到，公司最低现金保有量与经营规模高度正相关。假设公司最低现金保有量增长需求与公司营业收入的增长速度保持一致，根据前述对未来三年公司营业收入的预测，公司 2029 年末最低现金保有量需求将达到 13,782.08 万元，即未来三年公司新增最低现金保有量为 3,948.07 万元。

单位：万元		
项目	计算公式	计算结果
2025 年度营业收入	(1)	43,799.89
报告期末最低现金保有量（基于 2025 年度测算）	(2)	10,354.68
2029 年营业收入	(3)	60,500.07
2029 年末最低现金保有量（基于 2029 年度测算）	(4) = (2) × ((3) / (1))	14,302.75
未来期间新增最低现金保有量需求	(5) = (4) - (2)	3,948.07

③未来期间预计现金分红需求

未来期间分红资金需求与公司经营成果相关。2023 年至 2025 年，公司的现金分红占营业收入的比例分别为 0.00%、4.20%、7.17%。若以 2025 年度现金分红金额占营业收入比例为测算指数，对未来三年预计现金分红所需资金进行测算，未来三年预计现金分红所需资金分别为 3,257.49 万元、3,583.24 万元、3,941.57 万元，合计 10,782.30 万元。

④未来一年拟偿还债务

截至 2026 年 6 月 30 日，公司需要偿还的短期借款及一年内到期的非流动负债金额为 875.31 万元。

⑤公司未来拟投资项目需求

单位：万元

项目	金额	董事会（股东会）审议情况
硅零部件扩产项目（募投项目）	57,747.25	第三届董事会第十四次会议审议通过
碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目（募投项目）	30,138.46	
新建研发中心项目（募投项目）	20,643.13	
公司全资子公司中晶芯收购福建精工少数股东深圳融聚鼎信投资合伙企业（有限合伙）持有的福建精工 20.0002%股权	19,500.00	第三届董事会第十七次会议审议通过《关于公司收购控股子公司少数股东权益的议案》
硅零部件新品研发及配套硅材料扩产项目	58,649.80	第三届董事会第十六次会议、2026 年第三次临时股东大会审议通过
集成电路制造关键材料研发及产业化项目	32,562.63	
封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化项目	21,779.71	
江城国泰海通神工（武汉）创业投资基金合伙企业（有限合伙）认缴出资	4,500.00	第三届董事会第十次会议审议通过
合计	245,520.98	

注 1：根据深圳融聚鼎信投资合伙企业（有限合伙）、中晶芯、福建精工及神工股份四方签署的《关于福建精工半导体有限公司之股权转让协议》，深圳融聚鼎信投资合伙企业（有限合伙）将持有的福建精工 20.0002%股权转让至中晶芯，转让价格为 1.95 亿人民币。

注 2：公司作为江城国泰海通神工（武汉）创业投资基金合伙企业（有限合伙）有限合伙人，认缴出资额为人民币 6,000 万元，公司已出资 1,500 万元，尚未出资金额 4,500 万元。

综合考虑公司现有货币资金、资产负债结构、现金流状况、经营规模及变动趋势、日常营运资金周转情况、未来业务发展规划及流动资金需求等情况，公司未来期间总体资金缺口为 108,837.26 万元，具体测算过程如下：

单位：万元

项目	计算公式	金额
报告期末货币资金余额	1	30,394.18
报告期末受限的货币资金	2	560.07
报告期末易变现的各类金融资产余额	3	63,441.26
其他流动资产	4	1,012.43
可自由支配资金	5=1-2+3+4	94,287.81
未来期间经营活动现金流净额合计	6	68,356.27
最低现金保有量需求	7	10,354.68
未来期间新增最低现金保有量需求	8	3,948.07
未来三年预计现金分红	9	10,782.30

未来期间拟偿还债务	10	875.31
未来拟进行投资项目资金需求	11	245,520.98
未来期间资金需求合计	12=7+8+9+10+11	271,481.34
总体资金缺口	13=12-5-6	108,837.26

6、公司本次融资的必要性、融资规模的合理性

综上所述，截至 2026 年 6 月 30 日，公司可自由支配资金余额为 94,287.81 万元。公司未来期间经营活动现金流净额合计 68,356.27 万元，预计未来期间资金需求合计金额为 271,481.34 万元。经测算公司未来资金缺口为 108,837.26 万元，公司本次调整后的拟募集资金金额不超过 81,028.32 万元，未超过公司资金需求。公司基于战略发展考虑及资金需求募集资金，本次融资具有必要性、合理性。

八、公司硅零部件扩产、碳化硅陶瓷零部件研发及生产的具体产品类型及与报告期内公司产品的对应关系，并结合上述情况说明本次募投项目效益测算中单价、销量及毛利率等主要指标的测算依据，本次募投项目效益测算是否谨慎合理

（一）公司硅零部件扩产项目的具体产品类型及与报告期内公司产品的对应关系，并结合上述情况说明本次募投项目效益测算中单价、销量及毛利率等主要指标的测算依据，说明本募投项目测算具备谨慎性

硅零部件扩产项目正常年可实现营业收入为 63,050.00 万元（不含税），年利润总额为 20,907.80 万元，项目投资财务内部收益率为 24.34%（所得税后），投资回收期为 5.75 年（所得税后，含建设期 2 年）。本项目效益测算的具体情况如下：

1、产品单价测算依据及合理性分析

硅零部件产品预计售价根据公司历史年度产品单价水平和未来市场行情进行预测，充分考虑了未来市场竞争加剧及国产化率达到一定程度后市场相对饱和状态等因素的影响，预估单价约为报告期内平均单价的 6 折左右，单价的取值具备谨慎性。

2、产品销量测算依据及合理性分析

本项目规划建设期为 2 年，后续综合考虑下游市场需求、市场发展趋势、自身实际经营情况等因素，预计产能爬坡期为 3 年，T+3 年、T+4 年预测产量分别为规划产量目标的 40%、80%，T+5 年及以后年度预测产量达到规划产量目标的 100%，达产后预

计销量为 24,950 件/年。

近年来，国家对半导体行业发展的的大力支持、硅零部件产品市场需求持续增长、受益于半导体行业国产替代浪潮，本募投项目建设具备充分的必要性。根据 QY Research 及弗若斯特沙利文数据测算，2024 年中国半导体设备硅零部件市场规模约 50 亿元，2025 年约 58 亿元，预计 2030 年将达到 125 亿元，2025-2030 年年均复合增长率约 16.60%。全球半导体设备硅零部件市场规模 2024 年约 17.13 亿美元，预计 2030 年将达到 24.83 亿美元。本项目达产后年销售收入 63,050.00 万元（约 8,700 万美元），占预计 2030 年中国市场份额约 5.04%，市场容量足以消化本项目产能。

2023 年至 2025 年，公司硅零部件销量由 7,758 片增长至 34,123 片¹，复合增长率为 63.84%。同时，公司硅零部件的在手订单相对充足，主要供应国内半导体领域龙头企业。公司积极与重要战略合作伙伴持续进行新机型/新项目的合作研发，当未来新合作项目/机型完成时，公司适配新机型的硅零部件产品价格和销量将有明显增长，相关销售也呈现一定的阶段波动性。综合考虑公司历史年销售增速，以及下游市场持续扩张、国产化替代加速，该销量目标具备谨慎性及合理性。

3、毛利率测算依据及合理性分析

本募投项目的总成本测算依据：

①项目各类外购原辅材料、燃料采购的价格，根据国内当前市场近期实际价格和这些价格的变化趋势确定；

②固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目建筑物原值折旧年限为 20 年，残值率取 5%；新增机器设备原值折旧年限为 10 年，残值率取 5%；办公设备原值折旧年限为 5 年，残值率取 5%；

③项目新增软件按 10 年摊销，其他资产按 5 年摊销；

④该项目定员为 308 人，取平均年工资总额；

⑤修理费按固定资产原值的 0.2%估算；

¹ 该销量取值系公司以硅零部件主要产品之一聚焦环作为基准，以其他硅零部件产品的生产工时与聚焦环的生产工时比例作为计算标准，对硅零部件销量进行折算后的销量数据，与定期报告公告数据存在差异，与产能计算同口径。

⑥该项目正常年其他制造费用按营业收入的 5.8%估算（参照历史数据取值，下同）；其他管理费用按年营业收入的 1.0%估算；其他研发费用按年营业收入的 6.5%计算；其他销售费用按年营业收入的 1.5%估算。以上各项计入其他费用。

由此估算出，本项目综合毛利率为 43.13%，与报告期内公司硅零部件主要产品毛利率不存在重大差异，且毛利率取值具备谨慎性，可达成率相对较高，主要由于 2023 年硅零部件主要原材料的成本较高，且处于产品及市场开发的前期，毛利率相对较低，随着主要原材料的市场价格下滑、公司硅零部件产品生产工艺逐渐成熟优化、硅零部件的规模效应释放等因素影响，最近三年公司硅零部件毛利率呈增长态势且趋于稳定。

综上所述，“硅零部件扩产项目”的毛利率取值具备谨慎性，可达成率相对较高。

（二）碳化硅陶瓷零部件研发及生产项目的具体产品类型及与报告期内公司产品的对应关系，并结合上述情况说明本次募投项目效益测算中单价、销量及毛利率等主要指标的测算依据

碳化硅陶瓷零部件研发及产业化建设项目正常年可实现营业收入为 40,764.00 万元（不含税），年利润总额为 14,296.05 万元，项目投资财务内部收益率为 28.63%（所得税后），投资回收期为 5.27 年（所得税后，含建设期 2 年）。本项目效益测算具体如下：

1、产品单价测算依据及合理性分析

碳化硅陶瓷零部件项目产品包括 MOCVD 托盘、块体沉积环、8 寸外延套件和 12 寸外延套件四类。由于上述产品系公司新产品，因此单价以成本加成为基础，并结合未来市场同类型产品市场价情况进行预估。公司碳化硅陶瓷零部件产品已完成技术储备与产线规划。该项目单价测算采用了分阶段降价策略——前五年采用较高单价，后五年各产品单价均有所下调，充分考虑了未来同行业可比公司陆续投建产能落地的影响，体现了谨慎性原则。从行业角度分析，碳化硅陶瓷零部件作为半导体刻蚀设备的核心耗材，技术壁垒高、国产化率低，产品附加值较高。随着国内碳化硅陶瓷零部件国产化进程加速，产品价格从长期看将逐步下降但短期内仍将保持较高水平。本项目采用的分阶段降价策略与行业价格趋势预期一致，测算谨慎合理。

2、销量测算依据

本项目达产后年产能 10,200 个（套），销量测算依据如下：

①未来不断增长的市场空间：根据 Research and Markets 的数据，2024 年，全球半导体设备 SiC 陶瓷零部件市场规模达到约 13 亿美元至 19 亿美元，2025-2030 年年均复合增长率约为 7.0%-10.0%。根据 QY Research 的数据，2024 年，全球半导体设备 CVD-SiC 陶瓷零部件市场规模为 10.61 亿美元，预计 2030 年将增长至 18.53 亿美元，2024-2030 年年均复合增长率为 9.7%。根据 QY Research 的数据，中国 CVD-SiC 陶瓷零部件市场规模由 2022 年的约 2.00 亿美元增长至 2028 年的约 4.26 亿美元，2022-2028 年年均复合增长率约 13.44%，体现内需旺盛。

②半导体国产化替代机遇：目前碳化硅陶瓷零部件市场以境外供应商为主导，随着国产刻蚀设备厂商技术突破与市场份额提升，以及国际设备商逐步降低对国内供应商的认证壁垒，国产化替代空间持续扩大。公司作为国内半导体材料和零部件领域的领先企业，具备技术积累和客户资源优势，有望在国产化替代中占据有利位置。

③产能爬坡安排：本项目设定第 3 年生产负荷 30%，第 4 年 60%，第 5 年 80%，第 6 年及以后达到 100%满产。相比硅零部件扩产项目（第 3 年 40%、第 4 年 80%、第 5 年 100%），碳化硅陶瓷零部件项目的产能爬坡更为平缓，考虑了新产品从研发到产业化的进程及新客户的认证周期，体现了谨慎性。

3、毛利率测算依据

本募投项目的总成本测算依据：

①项目各类外购原辅材料、燃料采购的价格，根据国内当前市场近期实际价格和这些价格的变化趋势确定；

②固定资产折旧按照国家有关规定采用分类直线折旧方法计算，本项目建筑物原值折旧年限为 20 年，残值率取 5%；新增机器设备原值折旧年限为 10 年，残值率取 5%；办公设备原值折旧年限为 5 年，残值率取 5%；

③项目新增软件按 10 年摊销，其他资产按 5 年摊销；

④该项目定员为 151 人，取平均年工资总额；

⑤修理费按固定资产原值的 0.2%估算；

⑥该项目正常年其他制造费用按营业收入的 6.0%估算；其他管理费用按年营业收入

入的 1.0%估算；其他研发费用按年营业收入的 6.5%计算；其他销售费用按年营业收入的 1.5%估算。以上各项计入其他费用。

综合前述，由此可算出本项目毛利率为 44.65%。

公司尚未对上述碳化硅陶瓷零部件产品形成规模化销售，同行业可比公司珂玛科技、臻宝科技等无详细披露的碳化硅陶瓷零部件产品毛利率，现选取同行业可比公司综合毛利率进行比较，臻宝科技 2026 年 1-6 月综合毛利率为 46.73%，珂玛科技 2026 年 1-6 月综合毛利率为 48.51%，本项目预测毛利率 44.65%与可比公司综合毛利率水平相近。考虑到碳化硅陶瓷零部件技术壁垒较高、国产化替代初期竞争相对有限、未来市场需求持续增长的行业特点，管理层认为该毛利率水平具有合理性。

九、申报会计师核查情况

（一）核查程序

会计师执行了下列核查程序：

1、访谈发行人董事会秘书、财务负责人，查阅前次募投项目投资明细表、变更前后投资结构、资本性及非资本性支出划分明细，复核前次募投变更前后非资本性支出占比测算过程。

2、查阅本次募投各项目投资明细表，对比公司历史同类项目建设数据、同行业上市公司募投项目披露信息，核查投资构成测算依据公允性，识别是否存在重大差异；取得公司货币资金、交易性金融资产、其他流动资产明细，梳理可自由支配资金规模与既定用途；查阅公司已审议的对外投资、产业基金出资、股权收购等相关决议文件，结合经营规划测算未来三年整体资金需求，综合评估本次再融资必要性与融资规模合理性。

3、查阅本次募投效益测算资料，复核效益测算中单价、销量、毛利率等关键假设的测算逻辑，核对募投产品类型与报告期内已实现销售产品的对应关系，评估效益测算的谨慎性与合理性。

（二）核查意见

经核查，我们认为：

1、发行人已完整说明前次募投项目变更前后非资本性支出占比情况，相关测算依

据充分。

2、本次募投各项目投资构成清晰，各项投资测算具备相应参考依据，与公司同类历史项目、同行业可比公司募投项目相比不存在重大不合理差异；结合发行人业务规模、资产负债结构、可自由支配资金的规模与既定用途、报告期投资活动情况以及未来中长期各项资金需求，发行人本次再融资具备必要性，融资规模具备合理性。

3、发行人已经清晰说明硅零部件扩产、碳化硅陶瓷零部件研发及生产对应的具体产品类型，以及和报告期内公司产品的对应关系；本次募投效益测算中单价、销量、毛利率等主要指标系充分考虑行业竞争、客户验证、产能爬坡等因素后的取值结果，整体效益测算具备谨慎合理性。

2. 关于业务与经营情况

根据申报材料：（1）报告期内公司主营业务收入分别为 12,944.38 万元、29,955.94 万元、43,565.48 万元及 11,211.59 万元；境内地区收入占主营业务收入的比例分别为 56.74%、69.85%、76.58%和 57.08%；（2）报告期内公司主营业务毛利率分别为-0.84%、33.90%、44.76%、41.63%；半导体大尺寸硅片毛利率分别为-216.46%、-25.56%、-9.15%和-22.77%；（3）报告期内，公司实现归母净利润-6,910.98 万元、4,115.07 万元、10,203.71 万元和 2,538.53 万元；（4）截至 2026 年 3 月 31 日，公司应收账款账面价值 11,779.10 万元，存货账面价值 8,372.89 万元，报告期内公司存货跌价损失分别为-3,042.37 万元、-373.20 万元、-1,227.64 万元、-60.45 万元；（5）截至 2026 年 3 月 31 日，公司存在财务性投资 6,000 万元，为公司与国泰君安创新投资有限公司、江城产业投资基金（武汉）有限公司、湖北国芯产业投资管理有限责任公司共同设立“江城国泰海通神工（武汉）创业投资基金合伙企业（有限合伙）”，公司认缴出资额为 6,000 万元，认缴出资额分期实缴到位，已出资 1,500 万元。

请发行人说明：（1）结合下游主要客户资本开支投入情况及市场需求，以及境内外销售的主要客户情况，说明公司报告期内业绩波动较大的原因及合理性，是否与同行业可比公司的变动趋势存在重大差异；（2）公司硅零部件产品、大直径硅材料产品对于硅原料的主要加工步骤，上游硅原料价格对于公司毛利率变动的具体影响，并结合上述情况以及 IPO 募投硅片项目效益实现情况，说明报告期内公司毛利率大幅增长，半导体大尺寸硅片毛利率持续为负的原因；（3）停工损失产生的原因、涉及的主要产品线及对公司大尺寸硅片业务毛利的影响，大尺寸硅片业务涉及的相关产线及设备资产是否存在减值风险；（4）公司应收账款的账龄、期后回款、坏账准备计提政策等，以及国内客户及海外客户的逾期及期后收回情况等，说明公司坏账准备计提的充分性；（5）结合公司存货的库龄、期后结转、在手订单覆盖等情况，说明报告期内公司存货跌价准备计提的充分性，减值计提是否存在跨期的情况；（6）本次发行董事会决议日前六个月至今，公司是否存在新投入和拟投入的财务性投资；截至最近一期末公司财务性投资占比情况，公司是否存在金额较大的财务性投资。

请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。

回复：

发行人说明：

一、结合下游主要客户资本开支投入情况及市场需求，以及境内外销售的主要客户情况，说明公司报告期内业绩波动较大的原因及合理性，是否与同行业可比公司的变动趋势存在重大差异

（一）下游主要客户资本开支投入情况及市场需求对公司业绩的影响

公司下游主要客户为半导体设备厂商及硅零部件厂商，受下游晶圆厂资本开支影响较大。报告期内公司主营业务收入分别为 12,944.38 万元、29,955.94 万元、43,565.48 万元及 21,523.12 万元，主营业务收入整体呈上升趋势。

公司直接下游客户资本开支不易精确统计，故从整体资本开支规模、行业周期性特征等维度展开分析，下游资本开支投入情况及市场需求变化等因素对公司业绩的具体影响如下：

2023 年公司大直径硅材料业务占比较高，主要面向日韩硅零部件厂商；硅零部件业务占比较低，处于业务培育发展期。受终端消费电子需求疲软等原因，存储芯片库存高企，三星、SK 海力士、美光科技等存储大厂大幅削减资本开支，台积电全年资本开支亦较 2022 年下滑 16.1%。根据 SEMI 统计，全球半导体制造设备销售额为 1,063 亿美元，同比下降 1.3%，系 2019 年以来首次年度下滑。大直径硅材料、硅零部件作为半导体设备核心耗材，需求与晶圆厂产能利用率、设备出货量直接挂钩，2023 年海外主流晶圆厂稼动率下滑，公司下游日韩硅零部件客户面临去库存压力，导致公司大直径硅材料订单量同步大幅下行，大直径硅材料业务收入规模大幅收缩，公司大力发展的硅零部件业务处于客户认证与小批量供货的培育期，产能规模小、固定成本分摊高，尚未形成规模效应，无法对冲大直径硅材料业务的下滑压力。同时，叠加公司研发投入持续投入、固定资产折旧刚性计提等因素，公司 2023 年出现上市后首次亏损。

2024 年以来，全球半导体设备行业在 AI 算力需求爆发、先进制程扩产及供应链自主可控驱动下维持较高增速。根据 SEMI 统计，2024 年全球半导体设备销售额达 1,171 亿美元，同比增长 10%，2025 年全球半导体设备销售额进一步增长至 1,330 亿美元，同比增长 13.7%。中国大陆作为全球最大的半导体市场，半导体设备销售额增速更是远高于全球市场，于 2024 年达到 495.5 亿美元，同比增长 35%，2025 年保持稳定。同时，SEMI 预测 2026 年全球半导体制造设备销售额将达 1,659 亿美元，同比增长 23.2%。

据国际半导体产业协会(SEMI)发布的《300mm 晶圆厂 2027 年展望报告》显示，2025-2027 年全球 300mm 晶圆厂设备支出 预计将达到创纪录的 4,000 亿美元。公司主要客户客户 A 等也受益于下游晶圆厂资本开支增长实现了业绩稳步提高，2025 年度客户 A 营业收入为 3,935,311.24 万元，较 2024 年同比增长 31.89%；2026 年 1-6 月客户 A 营业收入 2,016,141.69 万元，同比增长 24.90%。

2024 年以来全球半导体行业结构性复苏，消费电子、传统存储芯片等成熟领域进入去库存周期的呈现阶段性调整，而与人工智能相关的新兴高端市场景气度高涨，科技巨头企业为提供人工智能服务而竞相投入资本开支，逻辑、存储等核心品类需求旺盛，下游晶圆厂扩产节奏提速，带动半导体设备销售额大幅增长，随之拉动上游材料与零部件的配套需求。

综上，报告期内公司业绩波动与全球及境内相关半导体行业周期走势相关，符合行业及下游市场需求变动趋势。

（二）境内外销售的主要客户情况对公司业绩的影响

报告期内，公司主营业务中境内和境外业务收入金额如下表所示：

单位：万元

地区	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
境内收入	12,289.83	57.10%	33,361.28	76.58%	20,924.79	69.85%	7,345.04	56.74%
境外收入	9,233.29	42.90%	10,204.20	23.42%	9,031.16	30.15%	5,599.34	43.26%
主营业务收入合计	21,523.12	100%	43,565.48	100.00%	29,955.94	100.00%	12,944.38	100.00%

报告期内，公司境内收入占比均在 56%以上，境外业务收入主要来源于日本、韩国等国家。2023 年到 2025 年公司境内收入占比较高且整体呈上升趋势，主要系国内半导体市场持续稳健增长，特别是受益于半导体设备国产化率提升，境内收入增幅较高。随着境外市场逐步恢复，2026 年上半年境外收入规模增速较快，占比回升。

报告期内，公司境内主营业务收入前五大客户如下所示：

单位：万元

期间	序号	客户名称	销售产品分类	销售金额	占境内收入的比例
2026	1	客户 A	硅零部件	3,861.59	31.42%

年 1-6 月	2	客户 B	大直径硅材料	1,986.29	16.16%
	3	客户 C	大直径硅材料	1,843.41	15.00%
	4	客户 D	硅零部件	1,359.77	11.06%
	5	客户 E	硅零部件	668.59	5.44%
合计				9,719.64	79.09%
2025 年度	1	客户 A	硅零部件	20,086.98	60.21%
	2	客户 B	大直径硅材料	4,169.81	12.50%
	3	客户 C	大直径硅材料	2,518.02	7.55%
	4	客户 D	硅零部件	1,175.53	3.52%
	5	客户 F	大直径硅材料	927.19	2.78%
合计				28,877.52	86.56%
2024 年度	1	客户 A	硅零部件	7,619.54	36.41%
	2	客户 B	大直径硅材料	5,017.03	23.98%
	3	客户 C	大直径硅材料	2,608.66	12.47%
	4	客户 F	大直径硅材料	1,202.19	5.75%
	5	客户 D	硅零部件	1,168.16	5.58%
合计				17,615.58	84.19%
2023 年度	1	客户 B	大直径硅材料	1,976.09	26.90%
	2	客户 E	硅零部件	1,708.09	23.25%
	3	客户 A	硅零部件	876.76	11.94%
	4	客户 C	大直径硅材料	630.66	8.59%
	5	客户 G	硅零部件	442.18	6.02%
合计				5,633.77	76.70%

注：上述销售金额根据受同一实际控制人控制下合并计算的口径进行列示。

如上述表格所示，报告期内境内主营业务前五大客户销售收入分别为 5,633.77 万元、17,615.58 万元、28,877.52 万元、9,719.64 万元，销售收入逐年增长主要系硅零部件业务国产替代红利集中释放，2024 年起国内半导体设备国产化进程加速，公司前期深度合作的核心设备厂客户进入批量供货阶段，硅零部件业务收入从 2023 年的 3,763.90 万元增长至 2025 年的 23,717.16 万元，成为拉动整体业绩增长的最主要动力。其中，第一大客户客户 A 2023 年采购额为 876.76 万元，2024 年快速提升至 7,619.54 万元，2025 年进一步增长至 20,086.98 万元。同时，客户 D、客户 H 等晶圆厂与设备厂客户持续导入，共同推动硅零部件业务不断增长。2026 年上半年客户 A 采购额下滑，主

要系客户采购计划阶段性调整，双方合作项目完成大批量交付及维保采购交付后，2026年上半年所需采购量低于2025年度同期，但预期未来双方合作关系稳定，伴随着后续合作项目及开发机台的逐步导入带来的配套耗材采购，发行人向客户A收入规模具有较强的持续性。

报告期内，公司主营业务境外前五大客户如下所示：

单位：万元

期 间	序号	客户名称	销售产品分类	销售金额	占境外收入的比例
2026 年 1-6 月	1	客户 I	大直径硅材料	3,521.32	38.14%
	2	客户 J	大直径硅材料	2,317.39	25.10%
	3	客户 K	大直径硅材料	1804.58	19.54%
	4	客户 L	大直径硅材料	1245.24	13.49%
	5	客户 M	大直径硅材料	300.86	3.26%
合计				9,189.39	99.52%
2025 年度	1	客户 J	大直径硅材料	5,311.73	52.05%
	2	客户 K	大直径硅材料	2,618.45	25.66%
	3	客户 L	大直径硅材料	1,337.00	13.10%
	4	客户 N	大直径硅材料	562.71	5.51%
	5	客户 O	大直径硅材料	155.6	1.52%
合计				9,985.49	97.86%
2024 年度	1	客户 J	大直径硅材料	3,381.27	37.44%
	2	客户 N	大直径硅材料	2,183.23	24.17%
	3	客户 K	大直径硅材料	2,044.25	22.64%
	4	客户 P	硅零部件	674.27	7.47%
	5	客户 Q	大尺寸硅片	342.76	3.80%
合计				8,625.78	95.51%
2023 年度	1	客户 N	大直径硅材料	2,111.96	37.72%
	2	客户 M	大直径硅材料	1,664.51	29.73%
	3	客户 J	大直径硅材料	795.45	14.21%
	4	客户 Q	大尺寸硅片	595.38	10.63%
	5	客户 K	大直径硅材料	198.89	3.55%
合计				5,366.18	95.84%

报告期境外前五大客户销售收入分别为 5,366.18 万元、8,625.78 万元、9,985.49 万

元、9,189.39万元，受益于全球半导体行业结构性复苏，特别是人工智能相关的新兴高端市场景气度高涨，日韩作为重要人工智能产业聚集地受益明显，但由于下游高景气市场需求向上游材料商传导具有一定滞后性，报告期前三年大直径硅材料业务平稳增长，2026 年上半年发行人大直径硅材料销售金额大幅提升。核心境外客户中，客户 J 2024 年采购额回升至 3,381.27 万元，较 2023 年增长 325.08%，2025 年进一步增长至 5,311.73 万元；客户 K2023 年采购额仅 198.89 万元，2024 年快速增长至 2,044.25 万元，2025 年达 2,618.45 万元，2026 年 1-6 月，公司与客户 I 合作规模扩大，系当期外销第一大客户，采购额为 3,521.32 万元，主要系其终端客户需求增加，共同推动硅材料业务结构性修复。

（三）结合上述情况说明报告期公司业绩波动原因及合理性分析

由上文可知，报告期内公司业绩持续增长，与全球半导体行业周期趋势整体相符。2023 年，受全球半导体行业下行、海外晶圆厂稼动率下滑及日韩客户去库存冲击，公司核心的大直径硅材料业务订单量收缩，而处于培育期的硅零部件业务尚未形成规模效应，导致公司出现上市后首次亏损；2024 年以来，全球半导体行业触底复苏，半导体设备市场高速增长，加之国内半导体设备国产化进程加速，公司前期深度合作的核心设备厂客户进入批量供货阶段，同时境外客户补库需求持续释放，共同推动公司订单增加、产能利用率攀升、规模效应显现，整体营业收入和净利润实现大幅增长。2026 年上半年营业收入同比增加主要系公司调整产品结构，同时受境外市场需求上升拉动所致，净利润同比下降主要系公司主营业务毛利率波动以及增加研发投入及期间费用有所增加所致。

（四）报告期内与同行业可比公司的变动趋势不存在重大差异

报告期内，公司与同行业可比公司营业收入、净利润的比较情况如下：

单位：万元

项目	证券名称	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度
		金额	变动	金额	变动	金额	变动	金额
营业收入	先锋精科	66,270.45	1.25%	123,772.76	8.98%	113,577.41	103.65%	55,771.69
	珂玛科技	59,221.36	13.80%	107,339.83	25.19%	85,738.20	78.45%	48,044.96
	有研硅	66,480.69	21.20%	100,524.57	0.93%	99,594.59	3.70%	96,040.33

	臻宝科技	48,352.85	31.98%	86,758.17	36.73%	63,450.10	25.31%	50,635.63
	平均值	60,081.34	17.06%	104,598.83	15.46%	90,590.07	44.66%	62,623.15
	神工股份	21,640.56	3.78%	43,799.89	44.68%	30,272.95	124.19%	13,503.32
净利润	先锋精科	5,503.79	-48.17%	18,889.58	-11.71%	21,394.62	166.52%	8,027.50
	珂玛科技	8,913.84	-48.13%	28,165.53	-9.43%	31,097.48	279.88%	8,186.07
	有研硅	15,359.47	23.10%	24,600.38	-8.63%	26,922.70	-6.60%	28,825.72
	臻宝科技	10,711.43	25.74%	22,593.08	48.78%	15,185.69	38.82%	10,939.41
	平均值	10,122.13	-11.87%	23,562.14	-0.37%	23,650.12	68.99%	13,994.68
	神工股份	4,436.26	-21.30%	12,253.78	162.12%	4,674.83	-	-7,017.28

如上表所示，报告期内公司营业收入整体变动趋势与同行业可比公司一致，均随半导体行业结构性复苏呈现增长态势，2023 年至 2025 年收入增速显著高于可比公司均值，核心业务结构、发展阶段、赛道景气度及基数效应共同作用的结果，增长具备真实业务支撑与合理性，具体说明如下：

首先，公司与可比公司的业务结构与发展阶段差异，硅零部件国产替代爆发贡献核心增量。同行业可比公司中，有研硅等主体以硅材料业务为主，业务步入成熟阶段，收入增长平缓；先锋精科、珂玛科技等企业收入体量已达较高规模。而公司 2023 年硅零部件业务尚处于客户认证转量产初期，2024 年起国内半导体设备国产化进程加速，公司深度绑定客户 A 等头部设备厂商，前期认证的硅零部件产品集中转量产，硅零部件业务成为拉动整体收入高增的核心引擎。同时公司大直径硅材料业务 2023 年处于周期底部，2024 年随海外需求修复逐步回升，修复式增长进一步放大了整体收入增速。

二是细分赛道景气度分化，公司精准受益于设备零部件国产替代红利。本轮半导体行业复苏呈现显著结构性特征，国内成熟制程晶圆厂扩产、设备供应链国产化是核心增长主线，刻蚀用硅零部件作为设备核心耗材，国产替代需求爆发式增长。可比公司业务布局相对多元，部分覆盖光伏、海外市场等复苏偏慢赛道，单一赛道收入弹性相对有限。公司聚焦刻蚀硅基耗材赛道，“材料+零部件”一体化优势突出，在国产替代浪潮中订单获取能力更强，收入弹性显著高于行业平均水平。

此外，基数效应放大增速差异。2023 年受全球半导体下行周期、海外客户去库存影响，公司大直径硅材料收入大幅收缩，整体收入处于周期底部，当年收入基数显著低于多数可比公司；而可比公司中多数企业 2023 年已实现平稳增长或小幅波动，基数

相对较高。低基数下的周期修复叠加新业务放量，共同推高了公司 2024 年收入同比增速，属于行业周期底部复苏阶段的正常现象。公司收入增速高于行业均值具备清晰的业务逻辑支撑，与半导体行业结构性复苏、国产替代加速的大趋势完全契合，不存在异常情形。

2026 年上半年公司营业收入增长节奏相对可比公司偏缓，主要系有研硅 2026 年 1 月完成对株式会社 DG Technologies 70% 股权的收购并纳入合并报表，此项收购增厚了有研硅营收规模；臻宝科技主要系碳化硅等高附加值产品放量、客户渗透率提升，故与可比公司差异具有合理性。

报告期内公司净利润变动趋势与可比公司存在差异，2023 年-2025 年公司净利润增长水平高于可比公司，一方面系公司 2023 年亏损影响，由于基数效应使得整体增速较高，另外公司通过产品结构调整、生产组织优化、规模效应提升，带动公司收入规模及盈利能力水平稳步提升。2026 年上半年公司净利润水平与同行业可比公司处于同一可比区间，公司净利润同比下滑，主要系其增加研发投入及期间费用有所增加，同时公司业务结构变动降低了整体毛利率水平。

二、公司硅零部件产品、大直径硅材料产品对于硅原料的主要加工步骤，上游硅原料价格对于公司毛利率变动的具体影响，并结合上述情况以及 IPO 募投硅片项目效益实现情况，说明报告期内公司毛利率大幅增长，半导体大尺寸硅片毛利率持续为负的原因；

（一）公司硅零部件产品、大直径硅材料产品对于硅原料的主要加工步骤

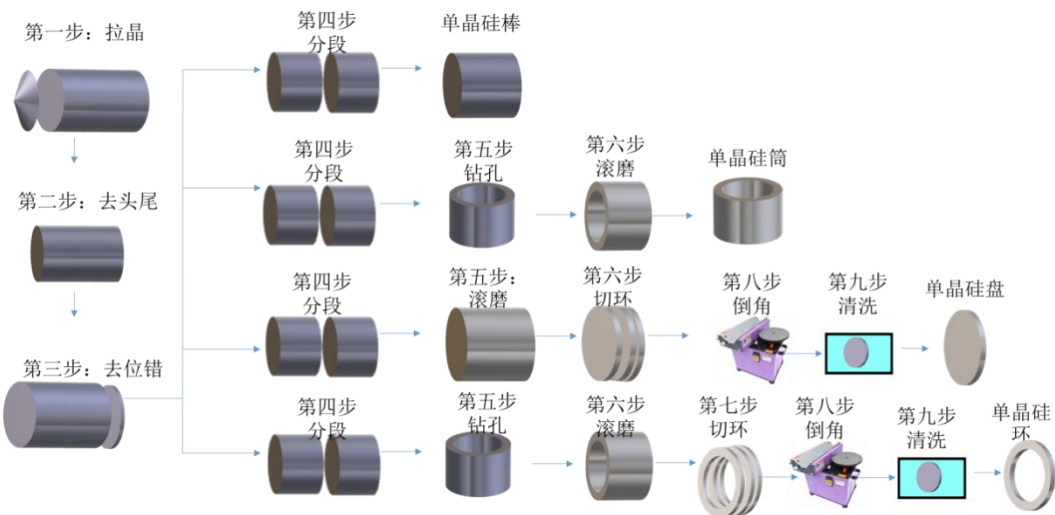
大直径硅材料产品和硅零部件产品为公司主要产品，大直径硅材料产品以原始多晶硅为原料，公司大直径硅材料产品是制造半导体刻蚀用硅零部件的关键基材；硅零部件产品由大直径硅材料产品进一步加工制成，并广泛应用于等离子刻蚀设备腔体内部，是芯片刻蚀环节中需定期更换的核心消耗件。

1、大直径硅材料产品

公司大直径单晶硅材料的制造工艺主要为直拉法，其特点是在一个封闭热场内，通过石墨加热器加热，在温度高达 1,420° C 时将高纯度石英坩埚中的原始多晶硅熔化；随后，用原子均匀排列的单晶体（即籽晶）接触熔液表面，使熔液中的硅原子按照籽

晶的原子排列规则进行有序排列，同时转动籽晶，再反转坩埚，将籽晶缓慢向上提升，经过引晶、放大、转肩、等径生长、收尾等过程，得到单晶硅棒产品。根据客户所需产品规格对单晶硅棒产品进行分段、钻孔、滚磨、切环、倒角、清洗等多道不同工序，最终加工得到硅筒、硅盘和硅环等不同产品形态的产品。

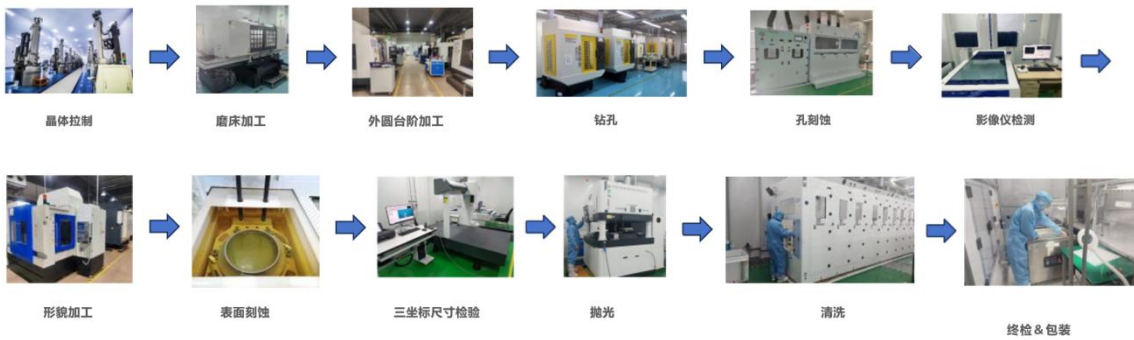
公司大直径硅材料产品生产工艺流程图如下所示：



2.硅零部件产品

上述“大直径硅材料产品”，经精密机械加工、高深宽比微结构制备、超净清洗、真空包装等一系列加工后，最终做成等离子刻蚀机用硅零部件。

公司硅零部件产品加工流程图如下所示：



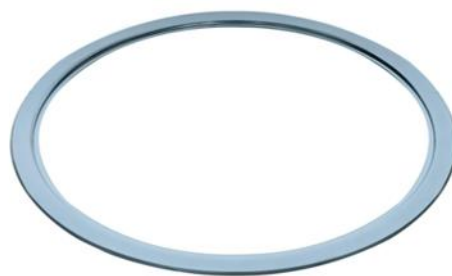
按照刻蚀腔体内部功能定位划分，公司硅零部件主要分为上电极、下电极以及腔

体结构件三大类：其中上电极主要承担刻蚀工艺气体均匀分配的功能，同时作为刻蚀腔体负极；下电极（硅托环/聚焦环等）主要用于承载晶圆片，同时承担等离子体电场调控功能；腔体结构件主要包含外套环、导气环、边缘环、屏蔽环等各类环类组件，用于腔体等离子约束、气流调控、腔体密封与部件承载保护。上述产品覆盖 8-12 英寸主流刻蚀设备规格，不同机型对应的产品在外形结构、微孔排布、尺寸精度、表面洁净度等方面存在定制化差异，具备多品种、小批量、定制化程度高的业务特征，产品性能指标需要匹配下游刻蚀设备及晶圆制造产线严苛的工艺验证要求，现已批量应用于国内头部刻蚀设备厂商、存储及逻辑晶圆制造企业的生产产线。

按大类产品划分，公司硅零部件产品典型示意图如下：



上电极



下电极



结构件

（二）上游硅材料价格对于公司毛利率变动的具体影响

1、报告期各产品毛利率变动整体情况

报告期内，公司主营业务收入主要来自大直径硅材料、硅零部件和半导体大尺寸硅片。其中大直径硅材料为公司传统核心业务，硅零部件为公司增速较快的成长业务，半导体大尺寸硅片仍处于客户认证和小批量供货阶段，收入占比较低。

上述各类产品在报告期内毛利率情况如下：

单位：万元

产品分类	2026 年 1-6 月		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
	收入	毛利率	收入	毛利率	收入	毛利率	收入	毛利率
大直径硅材料	13,513.72	63.05%	18,815.21	69.87%	17,404.39	63.85%	8,354.66	50.12%
硅零部件	6,899.07	39.90%	23,717.16	54.03%	11,849.41	39.55%	3,763.90	36.41%
半导体大尺寸硅片	1,110.33	-5.05%	1,033.11	-9.15%	702.14	-25.56%	825.83	-216.46%
主营业务收入合计及其毛利率	21,523.12	37.29%	43,565.48	44.76%	29,955.94	33.90%	12,944.39	-0.84%

报告期内，公司主营业务毛利率随各产品收入结构变化及单品盈利水平波动呈现阶段性变动。2026 年 1-6 月主营业务毛利率较 2025 年度略有下降，主要系主要产品毛利率阶段性回落所致。大直径硅材料作为公司传统核心业务，整体保持较高毛利率水平，2023 年-2025 年毛利率持续提升，2026 年 1-6 月毛利率有所回落，主要系当期大直径硅材料销售产品结构中低毛利规格占比提升，叠加部分产品销售单价下降，导致收入端毛利空间收窄；同时，部分产品处于规格切换、工艺调整及客户验证配合阶段，生产良率和产能利用率阶段性下降，单位产品分摊成本上升，导致大直径硅材料毛利率较 2025 年度下降。硅零部件作为公司第二增长曲线，收入规模快速扩张，毛利率整体呈上行趋势，但 2026 年 1-6 月毛利率较 2025 年度下滑，主要系单位成本下降未完全抵消销售单价下降影响，平均单价下降主要受当期销售产品结构变化影响，低单价规格产品销售占比提升，该品类收入占比提升对整体毛利率形成一定拖累；报告期内，公司半导体大尺寸硅片尚处在客户出现认证及小批量供货阶段，受产能利用率偏低、研发投入较高、良率尚未达到规模化生产水平影响，报告期各期均为负毛利率，随着该板块收入实现小幅增长，亏损幅度有所收窄。

整体来看，报告期内高毛利的大直径硅材料贡献主要盈利，硅零部件业务规模扩张带来新的业绩增量但盈利稳定性有待巩固，半导体大尺寸硅片业务仍处于投入期尚未实现盈利，各业务板块毛利率的分化以及收入结构的变化共同驱动公司主营业务综合毛利率上下波动。

2、报告期内硅材料价格情况

报告期内，公司硅材料的采购情况如下：

单位：千克、万元、元/千克

原材料类别	项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
多晶硅	采购量	393,930.00	487,640.00	243,570.00	27,869.27
	采购金额	2,034.20	1,971.18	879.94	501.30
	采购均价	51.64	40.42	36.13	179.88

报告期各期，公司多晶硅采购均价分别为 179.88 元/千克、36.13 元/千克、40.42 元/千克和 51.64 元/千克。2023 年度，公司多晶硅采购均价较高，主要系 2023 年初多晶硅市场价格仍然处于历史高位，同时公司生产用多晶硅等原材料主要采购自前期 2022 年高价格阶段，相关高价原材料成本对当期产品成本形成影响。2024 年度，公司多晶硅采购均价下降至 36.13 元/千克，较 2023 年度大幅下降，与多晶硅市场公开现货价格自 2023 年以来整体下行的趋势一致。2025 年度及 2026 年 1-6 月，公司多晶硅采购均价有所回升，主要受采购规格、采购时点、供应商结构及市场价格阶段性变化等因素影响。

根据中国国产多晶硅料一级料公开现货价格走势，2023 年初多晶硅现货价格处于较高水平，随后快速下降；2024 年度至 2025 年度，多晶硅现货价格整体处于低位；2026 年初价格阶段性回升后有所回落。公司多晶硅采购均价在 2023 年度较高、2024 年度大幅下降、2025 年度及 2026 年 1-6 月有所回升，与市场公开现货价格整体变动趋势整体趋同。

单位：美元/千克



数据来源：Wind

3、报告期内硅材料价格变动对公司毛利率变动影响

多晶硅是大直径硅材料的主要原材料，多晶硅原料价格的波动对公司毛利率有较大影响。受光伏级多晶硅原料“需求溢出”影响，2022年多晶硅原料的市场价格延续2021年的走势，全年多晶硅指数呈现不断上涨的趋势，2022年10月左右，多晶硅价格触及历史高点，随着上游多晶硅产能的扩充，2023年开始多晶硅指数出现较大回落，但仍居高位，2024年度多晶硅采购价格同比大幅下降。2024年以来多晶硅采购价格企稳并小幅提升，叠加国家对多晶硅产业深度治理，多晶硅价格逐步回归理性保持低位运行。

报告期各期，多晶硅采购均价分别为 179.88 元/千克、36.13 元/千克、40.42 元/千克和 51.64 元/千克。2024 年度多晶硅采购均价较 2023 年度明显下降，与公开市场多晶硅价格下行趋势一致，对大直径硅材料单位成本下降形成正向影响；2025 年度及 2026 年 1-6 月多晶硅采购均价虽有所回升，但公司受益于产品结构、生产组织及成本控制等因素影响，毛利率仍然保持在相对稳定状态。

大直径硅材料方面，报告期各期公司大直径硅材料毛利率分别为 50.12%、63.85%、69.87%和 63.05%。受益于多晶硅原材料采购成本的持续下降，大直径硅材料单位成本持续降低 2024 年度及 2025 年度的毛利率得到稳步提升。2026 年 1-6 月毛利率略有下降，主要受当期排产产品结构变化等影响，部分低毛利规格产品销售占比略有提升。

硅零部件业务方面，报告期各期公司硅零部件毛利率分别为 36.41%、39.55%、54.03%和 39.90%。2024 年度及 2025 年度毛利率上升，主要系硅零部件销量增加，生产良率提升，叠加部分高价值产品销量提升，销售规模扩大、良率提升及产品结构升级共同带动毛利率提升。2026 年 1-6 月毛利率较 2025 年度下降，主要系客户产品销售结构有所调整，低价值产品销售占比短期内有所增加。

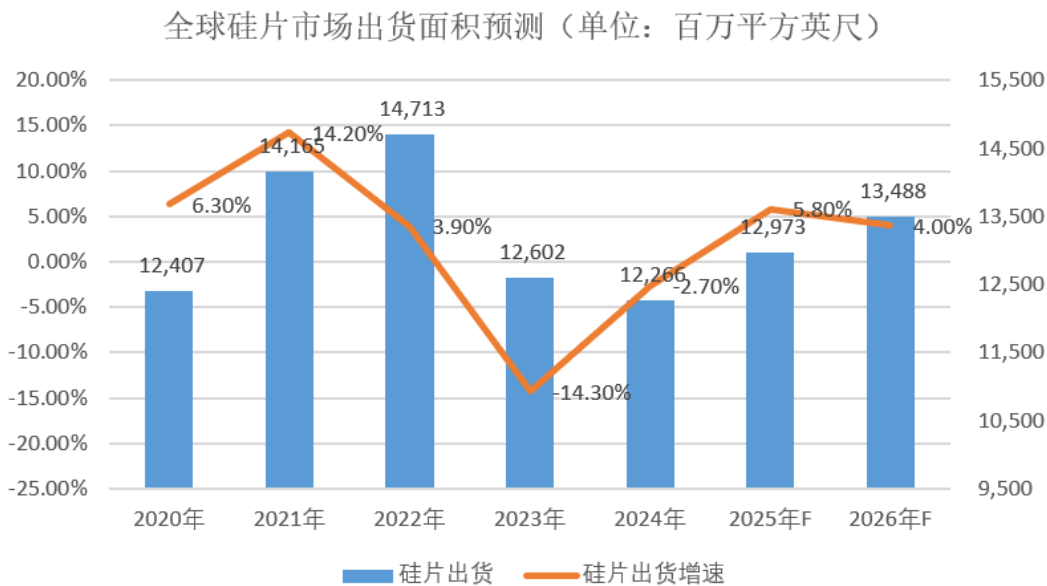
（三）IPO 募投硅片项目效益实现情况

公司首次公开发行股票募投项目包含 8 英寸半导体级硅单晶抛光片生产建设项目（以下简称“IPO 硅片募投项目”），该项目为面向半导体制造领域的半导体硅片产业化项目，项目建设完成后形成对应硅片生产产线。公司在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益作出任何承诺，其可研阶段测算的效益测算预计税后内部收

益率为 12.1%、预计项目所得税后投资回收期为 7.89 年。但该类半导体硅片产品需要通过下游晶圆厂多轮严苛的产品验证流程，验证周期长、导入节奏受下游客户资本开支、产线扩产计划、供应链选型策略多重外部因素影响，项目可研阶段效益模拟测算 是基于当时可获取的行业公开数据、客户意向、市场需求假设开展的预测，受宏观环境 影响，项目投资建设进度及投产后实际经营环境较 IPO 可研编制时点发生了一定变 化，项目暂未实现可研报告中预计的效益水平，具体情况如下：

首先，IPO 硅片募投项目原计划 2020 年开工建设，达到预定可使用状态日期为 2022 年 2 月，由于受国内外突发公共卫生事件及中美贸易战等因素影响，项目建设施 工进度、设备采购等受复工进度及物流管控等多方面因素影响，导致项目建设及辅助 设施的施工进度较原计划有所滞后，项目于 2024 年 1 月达到预定可使用状态。项目达 到预定可使用状态晚于预期，半导体硅片属于晶圆制造核心基材，下游晶圆厂供应商 导入需要经历材料可靠性测试、小批量试产、中试验证、大批量导入等完整流程，整 体认证周期通常较长，客观上影响到公司业务拓展时效性。

其次，根据 semi 预测，2020 年-2022 年全球硅片市场市场出货量持续增长，2023 年-2024 年有所下滑，2024 年以来，硅片市场出货量有所恢复，但仍未恢复至 2021 年、 2022 年水平。



公司 IPO 募投项目预测时点正值硅片市场高速成长期，公司未能如期投产一定程度 上错失高景气市场。在 IPO 募投项目投产后，即自 2024 年以来半导体硅片市场处于

结构性分化的复苏与转型阶段，复苏动力高度集中在以人工智能驱动的先进制程领域，而发行人硅片业务主要面向的成熟制程市场呈现温和且缓慢的复苏状态，整体市场供需存在失衡，下游客户新供应商导入节奏有所放缓，硅片产线难以快速实现满负荷生产，产线长期处于产能爬坡阶段，实际产能利用率显著低于预期。在产线折旧、人工、公辅动力等固定成本刚性发生的前提下，产能利用率不足直接摊薄单位产品毛利，是本项目暂未实现预期效益的核心客观因素。

综上，关于 IPO 募投项目效益未达预期，主要系受国内外突发公共卫生事件影响延缓了投产进度、投产前后硅片市场景气度存在较大差异、可研预测时点预测假设与实际情况存在一定差异所致。半导体行业具备强周期特征，下游晶圆厂资本开支、供应商导入节奏存在较强不确定性，该项目实施过程中部分可研假设条件未能完全落地，造成项目暂未达预期效益。公司已按照监管要求，在定期报告、前次募集资金使用情况专项报告中充分披露该项目实施进展、效益实现不及预期的现状及相关风险。

IPO 硅片募投项目对应的厂房、设备等相关资产仍然持续由公司管理使用，公司半导体硅片相关业务仍将结合下游客户验证进展、行业周期复苏节奏，持续开展工艺迭代、客户送样等工作，但客观上该业务后续能否实现达产盈利，仍然高度依赖半导体行业周期、下游客户供应链导入进度，存在较大不确定性。

（四）公司毛利率大幅增长，半导体大尺寸硅片毛利率持续为负具有合理性

1、综合毛利率大幅增长，核心由产品收入结构优化驱动

报告期各期，各产品收入占比情况如下：

单位：万元

产品大类	2026 年 1-6 月			2025 年		
	收入	占比	毛利率	收入	占比	毛利率
大直径硅材料	13,513.72	62.79%	63.05%	18,815.21	43.19%	69.87%
硅零部件	6,899.07	32.05%	39.90%	23,717.16	54.44%	54.03%
半导体大尺寸硅片	1,110.33	5.16%	-5.05%	1,033.11	2.37%	-9.15%
合计	21,523.12	100.00%	37.08%	43,565.48	100.00%	44.75%
产品大类	2024 年			2023 年		
	收入	占比	毛利率	收入	占比	毛利率
大直径硅材料	17,404.39	58.10%	63.85%	8,354.66	64.54%	50.12%

硅零部件	11,849.41	39.56%	39.55%	3,763.90	29.08%	36.41%
半导体大尺寸硅片	702.14	2.34%	-25.56%	825.83	6.38%	-216.46%
合计	29,955.94	100.00%	33.69%	12,944.39	100.00%	0.09%

报告期内，公司毛利率分别为 0.09%、33.69%、44.75%、37.08%。公司收入主要来源于大直径硅材料及硅零部件两大核心产品。报告期各期，两类产品合计收入占主营业务收入的比重分别为 93.62%、97.66%、97.63% 及 94.84%；半导体大尺寸硅片业务收入规模相对较小，各期收入分别为 825.83 万元、702.14 万元、1,033.11 万元、1,110.33 万元，收入占比仅分别为 6.38%、2.34%、2.37%、5.16%。

公司综合毛利率变动主要受大直径硅材料、硅零部件两大核心产品的产品结构、销售价格及成本变化驱动，半导体大尺寸硅片业务占比较低，除 2023 年外，主要毛利驱动因素源于两大核心产品，半导体大尺寸硅片业务对整体毛利率影响有限。

大直径硅材料受益上游多晶硅降价、产能利用率逐年提升、产品向高附加值大尺寸规格升级，毛利率持续走高，稳定贡献高毛利；硅零部件受益国产替代订单快速放量，产能利用率、生产良率持续改善，叠加高附加值产品占比提升，毛利率逐年上行，收入规模翻倍带来毛利总额快速扩张，成为业绩增长核心动力。

同时，半导体大尺寸硅片业务对综合毛利的拖累持续弱化。半导体大尺寸硅片虽持续亏损，但整体营收体量极小，且单位成本逐年优化、亏损幅度大幅收窄，对综合毛利率的负面影响逐年降低。两大核心高毛利产品收入规模、毛利率同步提升，叠加硅片业务亏损收窄，共同推动公司综合毛利率自 2023 年 0.09%提升至 2026 年 6 月的 37.08%，变动具备合理性。

2、半导体大尺寸硅片毛利率持续为负具有合理性

报告期内，公司半导体大尺寸硅片的收入、成本及毛利率如下表所示：

单位：万元

项 目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入	1,110.33	1,033.11	702.14	825.83
营业成本（不含停工损失）	1,166.35	1,127.64	881.63	2,613.42
毛利（不含停工损失）	-56.02	-94.53	-179.49	-1,787.59
毛利率（不含停工损失）	-5.05%	-9.15%	-25.56%	-216.46%

报告期内，公司半导体大尺寸硅片毛利率分别为-216.46%、-25.56%、-9.15%和-5.05%，持续为负，主要系该业务尚处于客户认证、小批量试制供货阶段，产能释放不足、生产良率较低导致单位产品分摊制造费用较高。但随着业务逐步推进，营业收入稳步提升，单位产品成本得到摊薄，毛利亏损规模持续收窄，毛利率负向程度大幅缓解，盈利水平较 2023 年度实现显著改善。

从业务推进节奏来看，报告期内公司半导体大尺寸硅片始终处于战略培育与客户验证阶段，整体商业化进展平缓，尚未进入规模化放量阶段。该业务定位为公司长期技术储备方向，核心进展集中于 8 英寸轻掺低缺陷抛光硅片的工艺优化、下游客户送样认证及小批量供货层面，虽已通过部分国内主流晶圆厂认证，但整体订单规模有限，未规划大规模产能扩张，也未形成稳定的批量交付能力。该产品毛利率持续为负，但该业务收入占比不足 7%，对公司整体盈利影响十分有限。当前产能利用率极低、阶段性亏损的特征，属于新业务爬坡阶段的行业普遍规律，不会改变公司整体高毛利的业务结构。

三、停工损失产生的原因、涉及的主要产品线及对公司大尺寸硅片业务毛利的影响，大尺寸硅片业务涉及的相关产线及设备资产是否存在减值风险；

（一）停工损失产生的原因、涉及的主要产品线

2023 年度，公司业务受到半导体行业周期波动等综合因素影响，下游需求减弱，大直径硅材料销量出现下滑。此外，由于半导体大尺寸硅片业务产品认证周期较长，短期内能够获得的批量订单规模有限。因此，公司为减少固定能耗、增加经济效益、优化排产计划、准确核算并呈现各业务实现情况，针对上述两项业务实施主动停工停产，报告期停工具体情况如下表所示：

涉及产品线	具体对应产品	停工期限
大直径硅材料	集成电路刻蚀用硅材料	2023 年 4 月至 2024 年 12 月，根据公司订单情况及生产计划，各月均有部分单晶炉及加工车间设备停工，公司根据各月不同工序开炉比例及产量比例为基础分配停工损失
半导体大尺寸硅片	8 英寸轻掺低缺陷硅片	2023 年 8 月至今，根据公司订单情况及生产计划，各月均有部分单晶生长设备及硅片加工工序设备停工，公司根据不同工序开工率及产量比例为基础分配停工损失

随着半导体行业回暖，2024 年开始大直径硅材料下游订单需求已逐步回升，2025 年公司恢复了大直径硅材料对应产线的排产计划，2025 年大直径硅材料产量较 2024 年提升 22.08%，收入规模进一步增长，公司结合行业周期与订单情况做出主动性排产调整，因此未再安排持续的计划性停工，2025 年及以后年度大直径硅材料未再单独归集停工损失，符合公司生产运营的实际安排。

报告期内公司半导体大尺寸硅片始终处于战略培育与客户验证阶段，整体商业化进展平缓，尚未进入规模化放量阶段。该业务定位为公司长期技术储备方向，核心进展集中于 8 英寸轻掺低缺陷抛光硅片的工艺优化、下游客户送样认证及小批量供货层面，虽已通过部分国内主流晶圆厂认证，但整体订单规模有限，部分产能处于阶段性闲置状态，在此背景下，2023 年 8 月至今，公司根据订单情况及生产计划，各月均有部分单晶生长设备及硅片加工工序设备停工。

（二）停工损失对公司大尺寸硅片业务毛利的影响

如上所述，公司半导体大尺寸硅片产品线根据不同工序开工率及产量比例为基础分配停工损失。报告期各期，半导体大尺寸硅片产品线产生的停工损失对大尺寸硅片业务毛利的影响情况如下：

单位：万元

大尺寸硅片项目	2026 年 1-6 月	2025 年度	2024 年度	2023 年度
营业收入①	1,110.33	1,033.11	702.14	825.83
营业成本（不含停工损失）②	1,166.35	1,127.64	881.63	2,613.42
毛利（不含停工损失）③	-56.02	-94.53	-179.49	-1,787.59
毛利率（不含停工损失）④=③/①	-5.05%	-9.15%	-25.56%	-216.46%
停工损失金额⑤	3,191.53	6,364.73	4,748.46	2,206.86
停工损失金额对毛利的直接影响额⑥=-⑤	-3,191.53	-6,364.73	-4,748.46	-2,206.86
停工损失金额对毛利率的直接影响⑦=⑥/①	-287.44%	-616.07%	-676.28%	-267.23%

上表可知，停工损失对公司大尺寸硅片业务毛利影响较大，报告期各期停工损失金额对毛利率的直接影响分别为-267.23%、-676.28%、-616.07%、-287.44%，若剔除停工损失影响，大尺寸硅片业务各期毛利率虽仍为负值，但毛利率呈增长趋势。公司将持续结合市场进展动态调整生产节奏，积极推进大尺寸硅片产品验证工作。

（三）大尺寸硅片业务涉及的相关产线及设备等资产是否存在减值风险

报告期各年末，公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的规定判断期末固定资产是否存在发生减值的迹象。如发现减值迹象，公司对相应的固定资产进行评估，考虑是否计提固定资产减值准备，按公允价值减去处置费用的净额和资产预计未来现金流量现值两者中的较高者确定可收回金额，若固定资产的可收回金额低于其账面价值，则按其差额计提减值准备并计入减值损失。

2023年度，公司大尺寸硅片业务产能利用率下降明显，经公司判断存在减值迹象，公司于当年聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对相关产线进行了评估，并出具了《锦州神工半导体股份有限公司因编制财务报告所涉及的固定资产与在建工程的可收回金额资产评估报告》（联信（证）评报字[2024]第Z0072号）。经评估，大尺寸硅片产线发生减值233.20万元，具体测算过程如下：

单位：万元

产线名称	账面价值（a）	可收回金额（b）[注]	减值金额（c=a-b）
半导体大尺寸硅片产线	29,079.75	28,846.56	233.20
合计	29,079.75	28,846.56	233.20

注：可收回金额按照公允价值扣除处置费用金额与未来现金流量现值孰高值确定，其中未来现金流量系基于当前对未来市场的合理预估确定，未来随着下游市场需求周期性波动，存在订单不及预期风险。

2024年度，大尺寸硅片产能利用率仍未及预期，经公司判断减值迹象依然存在，公司当年聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对相关产线进行了评估，并出具了《锦州神工半导体股份有限公司因编制财务报告所涉及固定资产的可收回金额资产评估报告》（联信(证)评报字[2025]第Z0117号）。经评估，大尺寸硅片产线发生减值697.76万元，具体测算过程如下：

单位：万元

产线名称	账面价值(a)	可收回金额(b)[注]	减值金额(c=a-b)
半导体大尺寸硅片产线	39,317.80	38,620.04	697.76
合计	39,317.80	38,620.04	697.76

2025年度，大尺寸硅片产品的产能利用率仍未及预期，公司当年聘请广东联信资产评估土地房地产估价有限公司对相关产线进行了评估，并出具了《锦州神工半导体股份有限公司因编制财务报告所涉及固定资产的可收回金额资产评估报告》（联信

（证）评报字[2026]第C0090号）。经评估，大尺寸硅片产线发生减值1,356.64万元。
具体测算过程如下：

单位：万元

产线名称	账面价值(a)	可收回金额(b)[注]	减值金额(c=a-b)
半导体大尺寸硅片产线	38,269.52	36,912.88	1,356.64
合计	38,269.52	36,912.88	1,356.64

综上，大尺寸硅片业务涉及的相关产线及设备资产存在减值风险，公司已在各期末根据实际情况对大尺寸硅片业务涉及的产线及设备资产进行减值迹象的判断，并在存在减值迹象时聘请评估机构开展评估工作，评价评估报告中使用的减值测试方法和模型、减值测试关键参数及假设的恰当性，依据评估结果计提减值准备，相关主要资产已按照企业会计准则要求计提减值准备。

四、公司应收账款的账龄、期后回款、坏账准备计提政策等，以及国内客户及海外客户的逾期及期后收回情况等，说明公司坏账准备计提的充分性

（一）公司应收账款的账龄、期后回款

报告期各期末，公司应收账款的整体情况如下所示：

单位：万元，%

项目	2026年6月30日	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
应收账款账面余额	7,130.95	12,249.74	9,544.79	6,032.49
减：坏账准备	145.26	198.79	363.59	813.52
应收账款账面价值	6,985.69	12,050.95	9,181.20	5,218.97
应收账款余额/当期营业收入	16.48	27.97	31.53	44.67
应收账款期后回款	3,639.47	12,103.87	9,544.79	6,032.49
应收账款期后回款占账面余额比例	51.04%	98.81%	100.00%	100.00%

注：期后回款统计截至 2026 年 8 月 11 日；截至 2026 年 6 月 30 日的应收账款余额/当期营业收入数据已年化处理

报告期各期末，公司的应收账款账面余额分别为 6,032.49 万元、9,544.79 万元、12,249.74 万元和 7,130.95 万元，应收账款占当期营业收入的比例分别为 44.67%、31.53%、27.97%和 16.48%。报告期各期末，公司应收账款的期后回款比例分别为 100.00%、100.00%、98.81%和 51.04%，2023 年至 2025 年各期末应收账款期后基本回款完毕。截至 2026 年 6 月 30 日应收账款回款比例较低主要系统统计截至时间距离报告期

未间隔较短所致。

2023 年至 2025 年，公司营业收入的复合年增长率为 80.10%，2023 年末至 2025 年末，公司应收账款账面余额的复合年增长率为 42.50%，2023 年末至 2025 年末，随营业收入增长，公司应收账款余额相应增长。公司不断加强对客户业务款项催收管理工作，通过每周汇总目标完成情况、每月制定回款目标、制定销售考核制度等方式强化应收账款管理，同时公司的客户优质、信用情况良好，形成营收规模增速高于应收账款增速的良性循环，应收账款占营业收入比重持续降低。

（二）公司应收账款的坏账准备计提政策

公司对于存在客观证据表明存在减值以及其他适用于单项评估的应收账款单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，依据信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。公司应收账款确定组合的依据包括应收海外客户组合、应收国内客户组合及应收关联方客户（合并范围内）组合。

对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。公司按组合计提应收账款坏账准备的预期信用损失率如下：

单位：%

项目	未逾期	逾期 0-90 天	逾期 90 天-1 年	逾期 1-2 年	逾期 2-3 年	逾期 3 年以上
应收海外客户	1.00	10.00	20.00	50.00	100.00	100.00
应收国内客户	1.00	10.00	10.00	20.00	50.00	100.00

公司采用逾期账龄法对应收账款计提坏账准备，主要系公司基于客户合作历史、客户资信状况及行业惯例等多项因素综合制定，体现了针对不同客户实行差异化、精细化信用管理的原则，具备合理性和准确性。通常情况下，公司与客户签订的销售合同中约定，以开具发票或获取提单为信用期起点。

《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》即新金融工具准则第五十三条规定：企业通常应当在金融工具逾期前确认该工具整个存续期预期信用损失。企业在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，企业无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的前瞻性信息的，不得仅依赖逾期信息来确定信用风险自初始

确认后是否显著增加；企业必须付出不必要的额外成本或努力才可获得合理且有依据的逾期信息以外的单独或汇总的前瞻性信息的，可以采用逾期信息来确定信用风险自初始确认后是否显著增加。公司根据新金融工具准则的要求，自 2019 年起根据应收账款逾期账龄计提相应的预期信用损失，符合会计核算的一贯性要求，确保财务报告的可比性和可比性。

公司采用逾期账龄法对应收账款计提坏账准备，主要系在信用期内客户的应收账款性质及信用状况一般不随账龄的变化而变化，在合同约定的收款日前账龄不是应收账款的风险特征。在合同约定的收款日后，随着应收账款逾期账龄的增加，客户对应的信用风险逐步增加，故公司按合同约定的信用期到期后计算逾期账龄，并以此为风险特征计提坏账准备，能够有效反映公司应收账款的风险特征。公司对未逾期贷款和逾期款项的划分标准为按照客户约定的付款条件，逾期贷款是指约定信用期但客户在超过信用期后仍未付款的应收账款。

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。公司将该应收账款按类似信用风险特征进行组合，并基于所有合理且有依据的信息包括前瞻性信息，根据应收账款逾期账龄计提相应的预期信用损失，符合企业会计准则的相关规定。

报告期各期末，公司无单项计提坏账准备的应收账款，按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款均为账龄组合。

报告期各期末，公司按组合计提坏账准备的应收账款情况如下：

1、应收海外客户

单位：万元，%

项目	账面余额	占比	坏账准备	计提比例
2026 年 6 月 30 日				
未逾期	1,438.07	85.40	14.38	1.00
逾期 0 至 90 天	114.24	6.78	11.42	10.00
逾期 90 天至 1 年	131.54	7.81	26.31	20.00
逾期 1 至 2 年	-	-	-	-
合计	1,683.86	100.00	52.11	3.09

项目	账面余额	占比	坏账准备	计提比例
2025 年 12 月 31 日				
未逾期	969.70	75.96	9.70	1.00
逾期 0 至 90 天	13.92	1.09	1.39	10.00
逾期 90 天至 1 年	292.96	22.95	58.59	20.00
逾期 1 至 2 年	-	-	-	-
合计	1,276.58	100.00	69.68	5.46
2024 年 12 月 31 日				
未逾期	921.76	89.94	9.22	1.00
逾期 0 至 90 天	50.32	4.91	5.03	10.00
逾期 90 天至 1 年	52.83	5.16	10.57	20.00
逾期 1 至 2 年	-	-	-	-
合计	1,024.91	100.00	24.82	2.42
2023 年 12 月 31 日				
未逾期	121.88	9.65	1.22	1.00
逾期 0 至 90 天	4.88	0.39	0.49	10.00
逾期 90 天至 1 年	641.84	50.82	128.37	20.00
逾期 1 至 2 年	494.25	39.14	247.13	50.00
合计	1,262.85	100.00	377.20	29.87

2、应收国内客户

单位：万元，%

项目	账面余额	占比	坏账准备	计提比例
2026 年 6 月 30 日				
未逾期	5,054.73	92.80	50.55	1.00
逾期 1 年以内	361.88	6.64	36.19	10.00
逾期 1 至 2 年	29.43	0.54	5.89	20.00
逾期 2 至 3 年	1.05	0.02	0.52	50.00
合计	5,447.09	100.00	93.15	1.71
2025 年 12 月 31 日				
未逾期	10,783.52	98.27	107.84	1.00
逾期 1 年以内	166.50	1.52	16.65	10.00
逾期 1 至 2 年	23.14	0.21	4.63	20.00

项目	账面余额	占比	坏账准备	计提比例
逾期 2 至 3 年	-	-	-	-
合计	10,973.16	100.00	129.11	1.18
2024 年 12 月 31 日				
未逾期	7,215.87	84.69	72.16	1.00
逾期 1 年以内	621.48	7.29	62.15	10.00
逾期 1 至 2 年	456.00	5.35	91.20	20.00
逾期 2 至 3 年	226.54	2.66	113.27	50.00
合计	8,519.88	100.00	338.78	3.98
2023 年 12 月 31 日				
未逾期	1,339.83	28.09	13.40	1.00
逾期 1 年以内	2,633.82	55.22	263.38	10.00
逾期 1 至 2 年	794.86	16.66	158.97	20.00
逾期 2 至 3 年	1.13	0.02	0.57	50.00
合计	4,769.64	100.00	436.32	9.15

报告期各期末，公司应收海外客户的未逾期应收账款占比分别为 9.65%、89.94%、75.96%和 85.40%；公司应收国内客户的未逾期应收账款占比分别为 28.09%、84.69%、98.27%和 92.80%。公司大部分应收账款均能按期收回，应收账款质量良好。

（三）国内客户及海外客户的逾期及期后收回情况

报告期各期末，公司国内客户及海外客户的逾期及期后收回情况如下：

1、海外客户

单位：万元，%

项目	账面余额	占比	期后回款金额	期后回款比例
2026 年 6 月 30 日				
未逾期	1,438.07	85.40	1,228.56	85.43
逾期 0 至 90 天	114.24	6.78	101.30	88.67
逾期 90 天至 1 年	131.54	7.81	-	-
逾期 1 至 2 年	-	-	-	-
合计	1,683.86	100.00	1,329.86	78.98
2025 年 12 月 31 日				
未逾期	969.70	75.96	968.86	99.91

项目	账面余额	占比	期后回款金额	期后回款比例
逾期 0 至 90 天	13.92	1.09	12.55	90.16
逾期 90 天至 1 年	292.96	22.95	162.02	55.30
逾期 1 至 2 年	-	-	-	-
合计	1,276.58	100.00	1,143.43	89.57
2024 年 12 月 31 日				
未逾期	921.76	89.94	921.76	100.00
逾期 0 至 90 天	50.32	4.91	50.32	100.00
逾期 90 天至 1 年	52.83	5.16	52.83	100.00
逾期 1 至 2 年	-	-	-	-
合计	1,024.91	100.00	1,024.91	100.00
2023 年 12 月 31 日				
未逾期	121.88	9.65	121.88	100.00
逾期 0 至 90 天	4.88	0.39	4.88	100.00
逾期 90 天至 1 年	641.84	50.82	641.84	100.00
逾期 1 至 2 年	494.25	39.14	494.25	100.00
合计	1,262.85	100.00	1,262.85	100.00

注：期后回款情况统计截至 2026 年 8 月 11 日

2、国内客户

单位：万元，%

项目	账面余额	占比	期后回款金额	期后回款比例
2026 年 6 月 30 日				
未逾期	5,054.73	92.80	2,102.29	41.59
逾期 1 年以内	361.88	6.64	199.98	55.26
逾期 1 至 2 年	29.43	0.54	7.34	24.95
逾期 2 至 3 年	1.05	0.02	-	-
合计	5,447.09	100.00	2,309.61	42.40
2025 年 12 月 31 日				
未逾期	10,783.52	98.27	10,776.15	99.93
逾期 1 年以内	166.50	1.52	165.80	99.58
逾期 1 至 2 年	23.14	0.21	18.49	79.90
逾期 2 至 3 年	-	-	-	-
合计	10,973.16	100.00	10,960.44	99.73

项目	账面余额	占比	期后回款金额	期后回款比例
2024 年 12 月 31 日				
未逾期	7,215.87	84.69	7,215.87	100.00
逾期 1 年以内	621.48	7.29	621.48	100.00
逾期 1 至 2 年	456.00	5.35	456.00	100.00
逾期 2 至 3 年	226.54	2.66	226.54	100.00
合计	8,519.88	100.00	8,519.88	100.00
2023 年 12 月 31 日				
未逾期	1,339.83	28.09	1,339.83	100.00
逾期 1 年以内	2,633.82	55.22	2,633.82	100.00
逾期 1 至 2 年	794.86	16.66	794.86	100.00
逾期 2 至 3 年	1.13	0.02	1.13	100.00
合计	4,769.64	100.00	4,769.64	100.00

注：期后回款情况统计截至 2026 年 8 月 11 日

（四）说明公司坏账准备计提的充分性

同行业可比上市公司应收账款按账龄结构计提坏账准备和预期信用损失政策不存在重大差异，具体对比如下：

单位：%

项目	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
先锋精科	5.00	20.00	30.00	50.00	80.00	100.00
臻宝科技	5.00	10.00	50.00	100.00	100.00	100.00

单位：%

项目	6 个月以内	7 个月-1 年	1-2 年	2-3 年	3 年以上
珂玛科技	1.85	8.53	13.71	55.58	100.00
有研硅	1.50	5.00	30.00	80.00	100.00

注：珂玛科技坏账计提准备数据来自 2025 年审计报告；珂玛科技参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

报告期各期末，公司及可比公司应收账款计提坏账准备金额占应收账款余额比例如下：

单位：%

项目	2026 年 1-6 月/2026 年 6 月 30 日	2025 年度/2025 年 12 月 31 日	2024 年度/2024 年 12 月 31 日	2023 年度/2023 年 12 月 31 日
先锋精科	5.46	5.35	5.39	5.25
珂玛科技	4.27	4.87	3.16	2.62
有研硅	1.51	1.50	1.63	1.50
臻宝科技	4.71	5.01	5.10	5.23
平均值	3.99	4.18	3.82	3.65
神工股份	2.04	1.62	3.81	13.49

报告期各期，公司应收账款账龄较短、逾期应收账款余额占比较低，按照逾期账款账龄方式计提应收账款减值准备，与可比公司计提方式存在一定差异。报告期各期，同行业可比公司的应收账款减值准备金额占比应收账款余额均值分别为 3.65%、3.82%、4.18%和 3.99%，公司应收账款减值准备金额占比应收账款余额均值分别为 13.49%、3.81%、1.62%和 2.04%，2025 年度及 2026 年 1-6 月公司计提应收账款减值准备金额较低主要系客户回款情况良好，逾期金额少所致。发行人应收账款坏账准备计提充分。

综上，发行人客户优质、信用情况良好，形成营收规模增速高于应收账款增速的良性循环，应收账款占营业收入比重持续降低。发行人按照应收账款逾期账龄计提相应的预期信用损失，符合企业会计准则的相关规定，且发行人保持相关会计处理的一致性，同行业上市公司采用逾期账龄方式计提坏账准备的案例常见；发行人应收账款坏账准备计提充分，期后回款情况良好。

五、结合公司存货的库龄、期后结转、在手订单覆盖等情况，说明报告期内公司存货跌价准备计提的充分性，减值计提是否存在跨期的情况

（一）存货库龄情况

报告期各期末，公司存货库龄情况如下：

单位：万元

项目	账面余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
截至 2026 年 6 月 30 日					
原材料	4,242.72	2,027.34	227.94	374.13	1,613.31
在产品	370.28	353.44	16.84	-	-
库存商品	5,670.96	4,106.45	905.28	246.28	412.95

项目	账面余额	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3 年以上
发出商品	178.47	137.14	34.04	7.30	-
委托加工物资	20.41	5.65	14.76	-	-
合计	10,482.84	6,630.02	1,198.86	627.71	2,026.26
截至 2025 年 12 月 31 日					
原材料	4,671.42	1,708.93	298.72	900.96	1,762.81
在产品	763.11	713.42	22.93	26.77	-
库存商品	5,933.63	3,682.55	1,316.77	413.47	520.84
发出商品	407.95	400.65	-	7.30	-
委托加工物资	19.21	19.21	-	-	-
合计	11,795.32	6,524.76	1,638.42	1,348.50	2,283.65
截至 2024 年 12 月 31 日					
原材料	5,620.31	1,157.66	1,127.75	3,162.31	172.59
在产品	1,011.87	871.13	140.74	-	-
库存商品	6,831.63	3,607.85	2,024.10	1,085.27	114.41
发出商品	108.34	101.04	7.30	-	-
委托加工物资	102.12	102.12	-	-	-
合计	13,674.27	5,839.80	3,299.89	4,247.58	287.00
截至 2023 年 12 月 31 日					
原材料	9,757.16	2,048.20	7,504.64	160.93	43.39
在产品	705.02	705.02	-	-	-
库存商品	7,425.62	5,593.00	1,695.13	114.96	22.53
发出商品	182.28	131.35	50.77	0.16	-
委托加工物资	50.33	49.90	0.43	-	-
合计	18,120.41	8,527.47	9,250.97	276.05	65.92

报告期各期末，公司存货余额持续降低，主要是公司销售增长消耗存货增加以及公司持续加强存货管理、提高存货周转率所致。

报告期各期，公司 3 年以上存货余额分别为 65.92 万元、287.00 万元、2,283.65 万元和 2,026.26 万元，其中 3 年以上原材料余额分别为 43.39 万元、172.59 万元、1,762.81 万元和 1,613.31 万元，即公司大额长账龄存货主要为原材料。公司长账龄原材料余额上升，主要原因系前期为保障上市募投项目投产需求，公司主动增加对硅片用多晶硅原料及部分石英坩埚、备品备件等硅片产品专用辅材的采购，作为安全库存储备。由

于公司大尺寸硅片业务进展迟缓，大尺寸硅片客户导入进度不及预期，导致相关原材料实际消耗量低于原计划，形成存货积压。

公司已建立存货库龄动态监控机制，结合在手订单、最近售价及客户需求判断是否具备使用价值，对于确认无使用价值、可变现净值低于账面价值的存货，足额计提跌价准备；对于尚存使用价值、可变现净值未低于账面价值的存货，则通过优先消耗、内部替代等方式尝试消化，进一步减少损失。

（二）存货期后结转、在手订单覆盖情况

1、存货期后结转情况

公司各期末存货期后结转情况如下：

单位：万元

项目	期末余额	期后结转金额	期后结转比例
截至 2026 年 6 月 30 日			
原材料	4,242.72	1,345.98	31.72%
在产品	370.28	316.06	85.36%
库存商品	5,670.96	3,052.51	53.83%
发出商品	178.47	88.36	49.51%
截至 2025 年 12 月 31 日			
原材料	4,671.42	2,494.63	53.40%
在产品	763.11	744.88	97.61%
库存商品	5,933.63	4,626.13	77.96%
发出商品	407.95	317.84	77.91%
截至 2024 年 12 月 31 日			
原材料	5,620.31	3,734.71	66.45%
在产品	1,011.87	995.60	98.39%
库存商品	6,831.63	5,933.96	86.86%
发出商品	108.34	108.34	100.00%
截至 2023 年 12 月 31 日			
原材料	9,757.16	8,117.43	83.19%
在产品	705.02	705.02	100.00%
库存商品	7,425.62	7,167.43	96.52%
发出商品	182.28	182.28	100.00%

注：期后结转情况统计截至 2026 年 8 月 30 日

（1）原材料期后结转情况

报告期各期末，原材料期后结转比例分别为 83.19%、66.45%、53.40%和 31.72%，整体呈现逐年下降趋势，主要系大尺寸硅片业务推进未及预期，相关原材料实际消耗速度低于前期预期，尚未结转的原材料主要为长账龄的硅片用原始多晶硅及部分石英坩埚、备品备件等硅片产品专用辅材，公司已根据可变现净值对相关原材料进行减值测试，并计提相应跌价准备。

（2）在产品期后结转情况

报告期各期末，在产品期后结转比例分别为 100.00%、98.39%、97.61%和 85.36%，公司在产品期后结转比例整体处于较高水平，公司在产品基本能够按计划完成后续加工并转入产成品。在产品主要对应已签订销售合同或客户需求明确的订单，公司已根据可变现净值对相关在产品进行减值测试，并计提相应跌价准备。

（3）库存商品期后结转情况

报告期各期末，库存商品期后结转比例分别为 96.52%、86.86%、77.96%和 53.83%，尚未结转的存货主要系：①长库龄库存商品，主要为订单不及预期的硅片类产品；②根据订单生产的库存商品，尚未完成发货交付；③寄售模式下存放于客户指定地点、客户尚未领用或结算的产品。公司已根据可变现净值对相关库存商品进行减值测试，并计提相应跌价准备。

（4）发出商品期后结转情况

报告期各期末，发出商品期后结转比例分别为 100.00%、100.00%、77.91%和 49.51%，报告期各期末，公司发出商品期末余额较低、期后结转比例较高。

2、在手订单覆盖情况

报告期各期末，公司在手订单覆盖情况如下：

单位：万元

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
原材料	4,242.72	4,671.42	5,620.31	9,757.16
在产品	370.28	763.11	1,011.87	705.02

项目	2026年6月30日	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
库存商品	5,670.96	5,933.63	6,831.63	7,425.62
发出商品	178.47	407.95	108.34	182.28
委托加工物资	20.41	19.21	102.12	50.33
小计	10,482.84	11,795.32	13,674.27	18,120.41
在手订单	7,055.31	7,211.12	7,239.72	4,470.56
在手订单覆盖率	67.30%	61.14%	52.94%	24.67%

报告期各期末，公司在手订单对存货的覆盖比例分别为 24.67%、52.94%、61.14% 和 67.30%。公司所处半导体硅材料和硅零部件行业的通行商务机制为月度/季度滚动短期实单，如签署年度框架协议，一般仅约定合作资质、定价规则、供货优先级等，不锁定固定采购量；具备排产、交付约束力的有效在手订单，均为客户按月或特定周期更新下达的短期采购单，其中多数客户的下单期间覆盖 1 个月，少数客户覆盖 2-3 个月，因此公司在手订单覆盖正常，对于库龄较长、订单覆盖不足的存货，公司已结合可变现净值测试结果对其足额计提跌价准备。

报告期内，公司根据市场需求动态调整备货策略，优化库存结构，持续推进客户认证及订单落地，公司在手订单对存货的覆盖率整体呈上升趋势。2023 年末在手订单覆盖率较低，主要系受半导体行业下行周期影响，下游客户需求下降，新增订单有限，前期为应对预期需求所备原材料及库存商品尚未完全消化；随着半导体行业回暖，部分重点客户认证通过，订单逐步释放，公司库存商品及在产品逐步实现销售转化，在手订单规模有所增长，存货覆盖率持续改善。

（三）报告期内公司存货跌价准备计提的充分性

1、发行人存货计提跌价准备政策及依据

公司存货跌价准备的确认标准和计提方法如下：资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

（1）对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货

在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后

的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

（2）对于需要经过加工的材料存货

在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价确定其可变现净值，以所生产的产成品的至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其成本。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

（3）公司一般按单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

（4）资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

跌价准备计算公式中“预计售价”的取数依据具体包括：（1）按照库存商品在手订单价格作为预计售价；（2）按照库存商品期后的最近售价作为预计售价；（3）通过客户询价单价作为预计售价；（4）若期后无相关库存商品的售价，则考虑历史售价或其他相近产品的售价；（5）其他无参考售价的存货的估计售价由管理层及销售人员在参考同类产品市场价格、市场供需关系、宏观经济运行情况等因素后综合确定。

具体而言，大直径硅材料主要产品存在较多的近期订单及历史订单，预计售价取数主要来源为最近售价及历史售价信息；大尺寸硅片存在近期订单及历史订单的，预计售价取数来源为最近售价及历史售价信息，尚未形成订单的大尺寸硅片预计售价取数来源为管理层及销售人员在参考同类产品市场价格、市场供求关系等因素后综合确定；硅零部件及其他产品存在近期订单及历史订单的，预计售价取数来源为最近售价及历史售价信息，尚未形成订单的硅零部件及其他产品预计售价取数来源为管理层及销售人员在参考同类产品市场价格、市场供求关系等因素后综合确定。

2、公司与同行业可比公司存货跌价准备的计提政策对比

公司与同行业可比公司存货跌价准备计提政策基本一致，具体如下表所示：

公司名称	存货跌价准备计提政策
先锋精科	资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额
珂玛科技	存货可变现净值按日常活动中估计售价或合同价格减去至完工时估计将要发生的成本和估计的合同履约成本和销售费用以及相关税费后的余额确定。公司按照市场销售价格预计存货的估计售价
有研硅	存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。在计算可变现净值的过程中，本公司根据可获取的市场信息或者已经签订的销售订单确定产品的估计市场价格，并按照历史经验及数据确定需要经过加工的存货至完工时估计将要发生的成本、估计的合同履约成本和销售费用及相关税费
臻宝科技	结合库龄与相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额综合确定可变现净值
神工股份	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值

3、公司与同行业可比公司存货跌价准备计提情况

报告期各期末，公司与同行业可比公司存货跌价准备计提情况对比如下：

公司名称	2026年6月30日	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
先锋精科	8.15%	8.85%	8.27%	10.58%
珂玛科技	12.80%	12.20%	8.96%	6.29%
有研硅	5.45%	5.37%	3.30%	4.54%
臻宝科技	9.57%	9.45%	11.61%	8.68%
平均值	8.99%	8.97%	8.04%	7.52%
神工股份	19.76%	25.89%	19.62%	19.22%

公司存货跌价准备计提比例高于同行业可比公司平均值，公司存货跌价准备计提充分。公司存货跌价准备计提比例较高主要原因为公司大尺寸硅片业务的部分客户认证工作未及预期，未能形成批量订单，产品销售价格无法覆盖单位成本，公司对相关的生产使用的原材料及大尺寸硅片产成品计提减值较多所致。

报告期各期，公司硅片产品相关存货的存货跌价准备占比情况如下：

单位：万元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日	2024年12月31日	2023年12月31日
账面余额	10,482.84	11,795.32	13,674.27	18,120.41
存货跌价准备	2,071.23	3,053.34	2,682.98	3,482.62
其中：半导体大尺寸	1,987.13	2,826.34	2,495.33	3,102.80

项目	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
硅片存货跌价准备				
半导体大尺寸硅片存货跌价准备占比	95.94%	92.57%	93.01%	89.09%

综上，报告期内，公司按照一致的会计政策对存货进行减值测算，即资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。公司存货跌价准备计提充分。

（四）减值计提是否存在跨期的情况

公司存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益，报告期各期公司存货跌价准备计提方法未发生变化。

公司主要产品分为大直径硅材料、硅零部件和大尺寸硅片，大直径硅材料和硅零部件产品毛利率较高，该部分产品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值后，部分产品发生跌价，计提减值准备。公司的大尺寸硅片业务由于处于产品认证阶段，目前销售的产品销售价格无法覆盖单位成本，按照产品的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，并计提减值准备。

公司存货跌价准备计提依据、计提方法未发生变化，当期计提存货跌价准备符合《企业会计准则第 1 号——存货》及其应用指南和讲解的规定，不存在跨期计提存货跌价准备的情形。

六、本次发行董事会决议日前六个月至今，公司是否存在新投入和拟投入的财务性投资；截至最近一期末公司财务性投资占比情况，公司是否存在金额较大的财务性投资

（一）本次发行董事会决议日前六个月至今，公司是否存在新投入和拟投入的财务性投资

2026 年 5 月 13 日为本次发行首次董事会决议日，本次向特定对象发行股票的方案及相关事项经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。

本次发行首次董事会决议日前六个月（2025 年 11 月 13 日）至本回复出具日期间，

发行人已于 2025 年 12 月 1 日、2025 年 12 月 4 日召开第三届董事会战略委员会第三次会议、第三届董事会审计委员会第十次会议、第三届董事会第十次会议审议通过了《关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司与国泰君安创新投资有限公司、江城产业投资基金（武汉）有限公司、湖北国芯产业投资管理有限责任公司共同设立“江城国泰海通神工（武汉）创业投资基金合伙企业（有限合伙）”，公司作为有限合伙人，认缴出资额为人民币 6,000 万元，认缴出资比例为 30%，认缴出资额分期实缴到位，截至本回复出具日已出资 1,500 万元。

（二）截至最近一期末公司财务性投资占比情况，公司是否存在金额较大的财务性投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司合并报表可能与财务性投资（包含类金融业务）相关的会计科目的情况如下：

1、交易性金融资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司交易性金融资产全部为安全性高、流动性好的银行理财产品 and 券商理财产品，且风险等级较低、期限较短，不属于收益波动大且风险较高的金融产品，不属于财务性投资。

2、其他应收款

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他应收款账面价值为 169.24 万元，主要为押金和保证金，不属于财务性投资。

3、其他流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他流动资产账面价值为 2,163.81 万元，主要为增值税借方余额重分类、定期存款及利息等，不属于财务性投资。

4、长期股权投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司长期股权投资中存在财务性投资 6,000.00 万元，为公司与国泰君安创新投资有限公司、江城产业投资基金（武汉）有限公司、湖北国芯产业投资管理有限责任公司共同设立“江城国泰海通神工（武汉）创业投资基金合伙企业（有限合伙）”，公司作为有限合伙人，认缴出资额为人民币 6,000 万元，认缴出资比例为 30%，认缴出资额分期实缴到位，已出资 1,500.00 万元。

5、其他权益工具投资

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他权益工具投资为 447.84 万元，主要系为拓展半导体硅片相关业务，公司于 2017 年 12 月参股辽宁天工半导体有限公司，该投资不以短期获利为目的，属于公司围绕产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，符合公司主营业务及战略发展方向。鉴于辽宁天工半导体有限公司的硅片项目尚未建设完成，基于谨慎性原则，将公司对辽宁天工的投资认定为财务性投资。

6、其他非流动资产

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他非流动资产为 619.00 万元，主要系预付长期资产购置款，不属于财务性投资。

综上，公司最近一期末财务性投资账面价值占合并报表归属于母公司净资产的比例未超过 30%，不存在财务性投资比例较高相关情形。

七、申报会计师核查情况

（一）核查程序

会计师执行了下列核查程序：

1、访谈发行人销售负责人、财务负责人、董事会秘书等主要管理层，了解报告期内下游半导体行业资本开支、境内外市场需求变化、主要客户经营及采购情况，分析报告期内收入、利润业绩波动的驱动因素；查阅半导体行业第三方研究报告、同行业可比上市公司定期报告，对比发行人经营指标变动趋势与同行业可比公司情况。

2、获取发行人报告期主营业务收入、成本明细，访谈生产、技术负责人，了解硅零部件、大直径硅材料产品完整加工工艺流程，分析上游硅原料价格传导路径及对各产品毛利率的影响；查阅 IPO 募投硅片项目建设、运行、效益相关资料，了解半导体大尺寸硅片业务亏损的形成原因，复核停工损失明细台账，核实停工损失对应的产品线、成本归集情况；获取硅片业务相关固定资产卡片、减值测试底稿，评估相关资产减值风险。

3、访谈发行人管理层，了解发行人主要客户的信用政策、结算方式等，了解公司的应收账款管理体系；获取发行人应收账款明细表及对主要客户的销售合同，检查发行人与主要客户的业务合作、信用政策和付款条款相关约定；获取发行人应收账款账

龄统计表，分析发行人应收账款逾期情况、逾期原因；获取期后回款统计表，检查发行人国内客户及海外客户的应收账款逾期及期后收回情况；了解发行人应收账款坏账准备计提政策、预期信用损失确认有关的内部控制制度；查阅同行业可比上市公司定期报告和招股说明书等公开资料，对比分析发行人与同行业可比公司的应收账款坏账准备计提政策以及应收账款计提坏账准备金额占应收账款余额比例，分析发行人坏账准备计提政策的恰当性。

4、通过对发行人主要客户执行访谈，实地了解发行人主要客户的基本经营情况、业务交易情况、结算情况、与发行人及其董监高和控股股东之间是否存在关联关系等。

5、获取并查阅发行人存货明细表、存货库龄明细表，了解并分析报告期末各项存货的构成和库龄情况，访谈发行人财务总监并查阅相关资料，分析存货各项构成的变动原因及合理性、相关存货库龄较长的原因及合理性，分析相关存货是否存在减值迹象，对应的存货减值准备金额等；获取发行人各期末各项存货的期后领用和结转情况；获取发行人各期末在手订单情况，结合在手订单情况检查各期末存货的订单覆盖；了解公司存货跌价准备的计提政策，分析跌价准备计提比例的合理性；获取发行人存货跌价测算表，检查存货跌价计提的准确性；查阅及对比同行业可比公司存货跌价计提政策和比例，分析公司存货跌价计提的充分性、合理性。

6、查阅相关法律法规中关于财务性投资及类金融投资的相关规定；获取并审阅发行人最近一期末交易性金融资产明细、其他应收款明细、其他流动资产明细、长期股权投资明细、其他权益工具投资明细、其他非流动资产明细，向发行人相关管理人员了解关于财务性投资及类金融投资的具体情况；分析自本次发行相关董事会决议日前六个月起至今发行人是否存在新投入和拟投入的财务性投资。

（二）核查结论

经核查，我们认为：

1、报告期内发行人业绩波动主要受全球半导体行业周期性变化、下游主要客户资本开支节奏、境内外市场需求结构变化、产品结构变动等多重因素共同影响，业绩波动具备商业合理性；报告期内发行人收入、利润变动趋势与半导体耗材细分行业整体发展情况基本匹配，不存在与同行业可比公司变动趋势的重大异常差异。

2、发行人硅零部件、大直径硅材料具备清晰完整的加工步骤，上游硅原料价格会按照生产传导逻辑对公司毛利率产生一定影响，但毛利率同时受产品结构、良率、客户结构等多重因素共同作用；受半导体大尺寸硅片业务尚处于客户验证爬坡阶段、产能利用率偏低、折旧及停工损失较高等因素影响，报告期内硅片业务持续亏损，该情况具备现实经营背景，具备合理性。

3、报告期内停工损失主要来源于半导体大尺寸硅片业务，对应相关产线设备已按照企业会计准则开展减值迹象评估，结合当前业务实际、未来经营规划审慎开展减值测试，相关资产减值风险已充分识别，发行人已在募集说明书充分披露相关情况及相关风险。

4、报告期各期末，发行人应收账款账龄较短、逾期应收账款余额占比较低、国内客户及海外客户期后回款情况良好，发行人按照逾期账款账龄方式计提应收账款减值准备，发行人应收账款坏账准备计提充分。

5、报告期各期末，公司存货余额持续降低，主要系公司销售增长消耗存货增加以及公司持续加强存货管理、提高存货周转率所致；报告期各期末，公司存货库龄结构、期后结转情况良好，公司在手订单对存货的覆盖率整体呈上升趋势；报告期内，公司按照一致的会计政策对存货进行减值测算，存货跌价准备计提充分，不存在跨期计提存货跌价准备的情形。

6、本次发行董事会决议日前六个月至本回复出具日期间，发行人存在新投入和拟投入的财务性投资，系发行人作为有限合伙人与专业机构共同投资设立产业基金即江城国泰海通神工（武汉）创业投资基金合伙企业（有限合伙），认缴出资额为人民币6,000.00万元，截至本回复出具日已出资1,500.00万元；截至最近一期末，发行人财务性投资主要系与专业机构共同投资设立产业基金及参股辽宁天工半导体有限公司相关其他权益工具投资，财务性投资账面价值占合并报表归属于母公司净资产的比例未超过30%，不存在财务性投资比例较高相关情形。

（此页无正文，为锦州神工半导体股份有限公司容诚专字[2026]110Z0393 号报告之签字盖章页。）



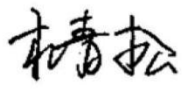
中国注册会计师：_____ 
吴 宇



中国注册会计师：_____ 
董博佳



中国·北京

中国注册会计师：_____ 
杜青松



2026 年 9 月 9 日



营业执照

(副本) (5-1)

统一社会信用代码

911101020854927874



扫描二维码了解更多
登记、备案、许可、
监管信息，体验更多
应用服务。

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
类型 特殊普通合伙企业
执行事务合伙人 刘维、肖厚发

出资额 8710.5 万元

成立日期 2013 年 12 月 10 日

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26

经营范围

一般项目：税务服务；企业管理咨询；软件开发；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：注册会计师业务；代理记账。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

业务报告附件专用

登记机关



2025 年 08 月 10 日

市场主体应当于每年 1 月 1 日至 6 月 30 日通过

<http://www.gsxt.gov.cn>

国家企业信用信息公示系统网址：

国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书



名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：刘维

主任会计师：

经营场所：北京市西城区阜成门外大街22号1幢1001-1至1001-26

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010032

批准执业文号：京财会许可[2013]0067号

批准执业日期：2013年10月25日

证书序号：0022698

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

2025年3月24日

中华人民共和国财政部制





姓名	吴宇
Full name	吴宇
性别	男
Sex	男
出生日期	1974-03-01
Date of birth	1974-03-01
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
Working unit	容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
身份证号码	21010219740301153X
Identity card No.	21010219740301153X



年度检验登记
Annual Renewal Registration

2021年8月7日

本证书经检验合格，继续
This certificate is valid for another
this renewal.



证书编号: 210103050004
No. of Certificate

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 2000 年 08 月 15 日
Date of Issuance





姓名	杜曹松
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1993-03-02
Date of birth	
工作单位	容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 辽宁分所
Working unit	
身份证号码	411424199303026613
Identity card No.	



续检登记
Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110100320439
No. of Certificate

批准注册协会: 辽宁省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs: 辽宁省注册会计师协会

发证日期: 2020 年 03 月 31 日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d